

ตู้ควบคุมความชื้นโดยใช้เพลเทียร์

HUMIDITY CONTROL CHAMBER USING PELTIER

นายกิตติพงษ์	ยศอาลัย	รหัส 47380218
นายอุกฤษณ์	ชัยยา	รหัส 47380277
นายธนวัฒน์	แก้วกัน	รหัส 47380334

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 5 เม.ย. 2553
เลขทะเบียน..... 14999836
เลขเรียกหนังสือ..... ๗/ร.
..... ๗ 674 ๗ 2550

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

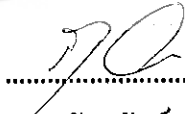
ปีการศึกษา 2550

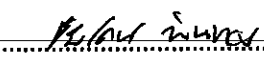


ใบรับรองโครงการวิศวกรรม

หัวข้อโครงการ	ผู้ควบคุมความชื้นโดยใช้เพลทเทียร์		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายกิตติพงษ์	ยศอาลัย	รหัส 47380218
	นายอุกฤษฏ์	ชัยยา	รหัส 47380277
	นายธนวัฒน์	แก้วกัน	รหัส 47380334
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.อัครพันธ์	วงศ์กิ่งแห	
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2550		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ อนุมัติให้โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะกรรมการสอบโครงการวิศวกรรม


.....ประธานกรรมการ
(ดร.อัครพันธ์ วงศ์กิ่งแห)


.....กรรมการ
(ดร.ชัชรัตน์ พินทอง)


.....กรรมการ
(อาจารย์ปิยคณีย์ ภาชนะพรรณ)

หัวข้อโครงการ	ตู้ควบคุมความชื้น โดยใช้เพลเทียร์		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายกิตติพงษ์ ยศอาลัย	รหัส	47380218
	นายอุกฤษฏ์ ชัยยา	รหัส	47380277
	นายธนวัฒน์ แก้วกัน	รหัส	47380334
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห		
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2550		

บทคัดย่อ

ตู้ควบคุมความชื้น โดยใช้เพลเทียร์นี้ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการสร้างตู้ควบคุมความชื้นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการซื้อเครื่องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ

ตู้ควบคุมความชื้นประกอบด้วยส่วนควบคุมและส่วนที่ถูกควบคุม ส่วนควบคุมจะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) ประมวลค่าอุณหภูมิและความชื้นจากไอซีวัดอุณหภูมิและความชื้นเบอร์ SHT15 และจะแสดงผลที่แอลซีดี ในการควบคุมการทำงานของตัวควบคุมความชื้น จะใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้กับ เพลเทียร์ (PELTIER) โดยจะใช้แผงโลหะที่เป็นอลูมิเนียมด้านเย็นเป็นตัวจับความชื้นภายในตู้ควบคุมความชื้น สามารถควบคุมและตั้งค่าเป้าหมายของความชื้นตั้งแต่ 10 ถึง 90 % RH

Project Title	Humidity Control Chamber Using Peltier.		
Name	Mr. Kittipong	Yosarlai	ID. 47380218
	Mr. Ukrit	Chaiya	ID. 47380277
	Mr. Thanuwat	Kaewkun	ID. 47380334
Project Advisor	Dr. Akaraphunt	Vongkunghae	
Major	Electrical Engineering.		
Department	Electrical and Computer Engineering.		
Academic Year	2007		

.....

ABSTRACT

This project is a model for creating a small or large size humidity control chamber. It can reduce the cost to purchase temperature and humidity controllers from abroad.

The humidity controller consists of a controller and a regulator. The control part uses a Microcontroller (MCS-51) for processing humidity values from an IC measuring temperature and humidity no.SHT15 and displays results on a LCD. In controlling the operation of the original humidity, a DC source of electricity is used to power a Peltier by using an aluminum control panel on cool plate to catch the humidity in the chamber. It can control the target value of humidity from 10 to 90 %RH.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบและสร้างผู้ควบคุมความชื้นโดยใช้เพลทเทียร์ ซึ่งจะไม่มีทางสำเร็จไปได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลดังต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.อัครพันธ์ วงศ์ถิ๊งแห อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่คณะผู้จัดทำเป็นอย่างดีตลอดมา

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และให้คำส่งสอนจนคณะผู้จัดทำมีความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ โครงการในครั้งนี้

และที่สำคัญที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนแก่คณะผู้จัดทำจนทำให้คณะผู้จัดทำทุกคนมีวันนี้ได้ ซึ่งเป็นพระคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้

ท้ายนี้คณะผู้จัดทำใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำโครงการ

นายกิตติพงษ์ ยศอาลัย รหัส 47380218

นายอุกฤษฏ์ ชัยยา รหัส 47380277

นายธนวัฒน์ แก้วกัน รหัส 47380334

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 งบประมาณที่ใช้ทำโครงการ.....	3

บทที่ 2 ทฤษฎีเบื้องต้น

2.1 ความชื้น (Humidity).....	4
2.1.1 ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity).....	4
2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity).....	4
2.2 ความเป็นมาของเพลเทียร์.....	6
2.3 หลักการทำงานของอุปกรณ์เพลเทียร์ (Peltier).....	7
2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เพลเทียร์.....	7
2.4 เซลล์และการเก็บรักษาอุปกรณ์.....	11

บทที่ 3 การออกแบบ

3.1 แนวคิดในการออกแบบ.....	13
3.1.1 การใช้เพลเทียร์ควบคุมความชื้น.....	14

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.2 การออกแบบวงจร.....	16
3.2.1 การทำงานของวงจร.....	17
3.2.2-LCD-Module.....	19
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของวงจรควบคุมอุณหภูมิและความชื้น.....	20
3.3.1 โปรแกรมหลัก 1 โปรแกรมหลักสำหรับควบคุมความชื้น.....	21
3.3.2 โปรแกรมย่อยสำหรับตั้งค่าความชื้นค่าสูง.....	22
3.3.3 โปรแกรมย่อยสำหรับตั้งค่าความชื้นค่าต่ำ.....	23
3.4 การออกแบบตู้ควบคุมความชื้น (Chamber).....	24
3.4.1 โครงสร้างตู้ควบคุมความชื้น.....	24
3.4.2 ฝาปิดตู้.....	25
บทที่ 4 การปฏิบัติและการทดลอง	
4.1 การสร้างวงจรควบคุมความชื้น.....	26
4.2 การติดตั้งเพลทเทอร์.....	27
4.3 โครงสร้างของตู้ควบคุมความชื้น.....	28
4.4 การทดลอง.....	30
4.5 ผลการทดลอง.....	30
4.5.1 การทดลองช่วงที่ 1.....	31
4.5.2 การทดลองช่วงที่ 2.....	32
4.5.3 การทดลองช่วงที่ 3.....	33
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน	
สรุปผลการดำเนินงาน.....	34
เอกสารอ้างอิง.....	35
ภาคผนวก.....	36
ประวัติผู้เขียนโครงการ.....	87

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 การจัดการควบคุมความชื้นที่อุณหภูมิปกติ, ความชื้นต่ำ.....	12
3.1 ตารางชื่อและหน้าที่ของสัญญาณต่างๆของ LCD.....	19
4.1 ผลการทดลองเมื่อตั้งค่าความชื้น 50-60%.....	31
4.2 ผลการทดลองเมื่อตั้งค่าความชื้น 40-50%.....	32
4.2 ผลการทดลองเมื่อตั้งค่าความชื้น 30-40%.....	33



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โนโมกราฟและการใช้งาน.....	5
2.2 การเกิดซีเบ็ค โวลต์เตจ.....	6
2.3 วงจรการทดลองเพลทีयर.....	6
2.4 ปรากฏการณ์เพลทีयर.....	7
2.5 การจัดเรียงตัวของ P-N Junction ภายในตัวเพลทีयर.....	9
2.6 ลักษณะของการส่งผ่านพลังงานความร้อนระหว่างเพลตรอนกับเพลตเย็น.....	9
2.7 ลักษณะรูปร่างของเพลทีयरที่ใช้กันทั่วไป.....	10
2.8 กราฟการเจริญเติบโตของเชื้อรา.....	11
2.9 ช่วงที่เหมาะสมต่อการควบคุมความชื้นให้แก่อุปกรณ์ชนิดต่างๆ.....	12
3.1 การทำงานของการควบคุมความชื้น.....	13
3.2 Block Diagram ของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Microcontroller.....	14
3.3 หลักการควบคุมความชื้นของอุปกรณ์เพลทีयर.....	15
3.4 วงจรควบคุมความชื้นที่ออกแบบ.....	16
3.5 Block Diagram ของตัวตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิ SHT15.....	18
3.6 การต่อใช้งานจอแสดงผล LCD.....	19
3.7 แผนภาพโปรแกรมหลัก 1.....	21
3.8 แผนภาพโปรแกรมน้อย 1.....	22
3.9 แผนภาพโปรแกรมน้อย 2.....	23
3.10 โครงสร้างของผู้ควบคุมความชื้น.....	24
3.11 โครงสร้างฝาปิดผู้ควบคุมความชื้น.....	25
4.1 วงจรควบคุมความชื้นที่ประกอบเสร็จแล้ว.....	26
4.2 การติดตั้งเพลทีयरเข้ากับ Heat Sink.....	27
4.3 โครงสร้างของผู้ควบคุมความชื้นที่ทำการประกอบ.....	28
4.4 โครงสร้างของฝาปิดผู้ควบคุมความชื้น.....	28
4.5 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความชื้นเข้ากับผู้ควบคุมความชื้น.....	29
4.6 ผู้ควบคุมความชื้นเมื่อประกอบเสร็จแล้ว.....	29
4.7 การทำงานของผู้ควบคุมความชื้น.....	30

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.8 กราฟผลการทดลองช่วงที่ 1.....	31
4.9 กราฟผลการทดลองช่วงที่ 2.....	32
4.10 กราฟผลการทดลองช่วงที่ 3.....	33



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ความชื้นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประสบปัญหาในการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งผลผลิตทางการเกษตร เมื่อมีความชื้นสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปอาจสร้างความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ได้ เช่น เกล็ดของกล่องถ้ำรูป เมื่อเก็บกล่องไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เชื้อราในบริเวณนั้นจะสร้างความเสียหายแก่เกล็ดของกล่องเนื่องจากเมื่อมีความชื้นสูงส่งผลให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นการรักษาความชื้นให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในการเก็บรักษาอุปกรณ์ เพราะจะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ เมื่อมีสิ่งที่สามารถควบคุมความชื้นได้ก็จะทำให้เก็บรักษาอุปกรณ์ได้นานและมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้ผู้จัดทำได้นำเสนอเกี่ยวกับผู้ควบคุมความชื้น อธิบายถึงคุณสมบัติ หลักการใช้งาน และการนำผู้ควบคุมความชื้นนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความชื้นได้ตามต้องการและสะดวกต่อการใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมความชื้นที่ใช้ควบคุมความชื้นภายในตู้ควบคุมความชื้น

1.2.2 เพื่อนำผู้ควบคุมความชื้นไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.2.3 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมสำหรับใช้กับวงจรควบคุมความชื้น

1.2.4 เพื่อสามารถควบคุมความชื้นได้ตามความต้องการ

1.2.5 เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจเพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาต่อไป

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ตู้ควบคุมความชื้นขนาด 20×33×25 เซนติเมตร

1.3.2 ศึกษาเกี่ยวกับช่วงของความชื้นที่ใช้ในการควบคุม

1.3.3 อธิบายหลักการทำงานและคุณสมบัติของ

- อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสร้างตู้ควบคุมความชื้น
- วงจรควบคุมความชื้นที่อยู่ภายในตู้ควบคุมความชื้น

1.3.4 เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับวงจรควบคุมความชื้น โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

1.3.5 ทำการทดสอบโปรแกรมและวงจรควบคุมความชื้น

1.3.6 สรุปผลและนำเสนอโครงการ

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

	2550			2551				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1. ศึกษาหลักการทํางาน ของวงจรควบคุมความชื้น และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน วงจร	↔							
2. ทำการศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติต่างๆของวงจร และการใช้งานของวงจร		↔						
3. ศึกษาการเขียนโปรแกรม ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้ ควบคุมวงจร			↔					
4. เขียนโปรแกรมเพื่อ เชื่อมต่อกับวงจรควบคุม ความชื้น และทำการทดสอบ โปรแกรม					↔			
5. สรุป วิเคราะห์ผล และ จัดทำรายงาน							↔	

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรควบคุมความชื้น
- 1.5.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับวงจรควบคุมความชื้น
- 1.5.3 สามารถใช้ตัวควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.5.4 สามารถนำวงจรควบคุมความชื้นไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม
- 1.5.5 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความชื้น และสามารถ

วิเคราะห์เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมได้

1.6 งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงการ

ค่าหนังสือประกอบการทำโครงการ	1,000	บาท
ค่าถ่ายเอกสาร	500	บาท
ค่ากระดาษ	500	บาท
ค่าปริ้นท์งาน	500	บาท
ค่าอุปกรณ์	2,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,500	บาท

บทที่ 2

ทฤษฎีเบื้องต้น

2.1 ความชื้น (Humidity)

ความชื้น (Humidity) หมายถึง ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเมื่อน้ำได้รับความร้อน น้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอเรียกว่า การระเหย ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอ เรียกว่า ความร้อนแฝง (Latent Heat) เมื่ออากาศเย็นลงไอน้ำจะเริ่มกลั่นตัวเป็นละออง และคายความร้อนแฝงออกมาด้วย อากาศจะได้รับไอน้ำได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้นอุณหภูมิจึงเป็นตัวกำหนดปริมาณไอน้ำในอากาศ อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำถ้าอากาศไม่สามารถรับไอน้ำได้เรียกว่า ไอน้ำอิ่มตัว (Saturate)

2.1.1 ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)

คือน้ำหนักของไอน้ำที่มีอยู่จริงในปริมาตรของอากาศจำนวนหนึ่งคำนวณได้จาก น้ำหนักของไอน้ำต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของอากาศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าความชื้นสัมบูรณ์คือ ความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศหน่วยคิดเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่น น้ำหนักของไอน้ำ 25 กรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมบูรณ์มักจะไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ในทางอุตุนิยมวิทยาเพราะเมื่ออากาศลอยตัวขึ้นหรือจมตัวลงจะทำให้ปริมาตรของอากาศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริเวณรอบ ๆ ความกดอากาศจะเปลี่ยนแปลง แม้ว่าไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่น ไอน้ำที่มีอยู่จำนวนไม่เท่ากันเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้น ความชื้นสัมบูรณ์ลดลง แต่เมื่อปริมาตรลดลง ความชื้นสัมบูรณ์จะเพิ่มขึ้น

2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

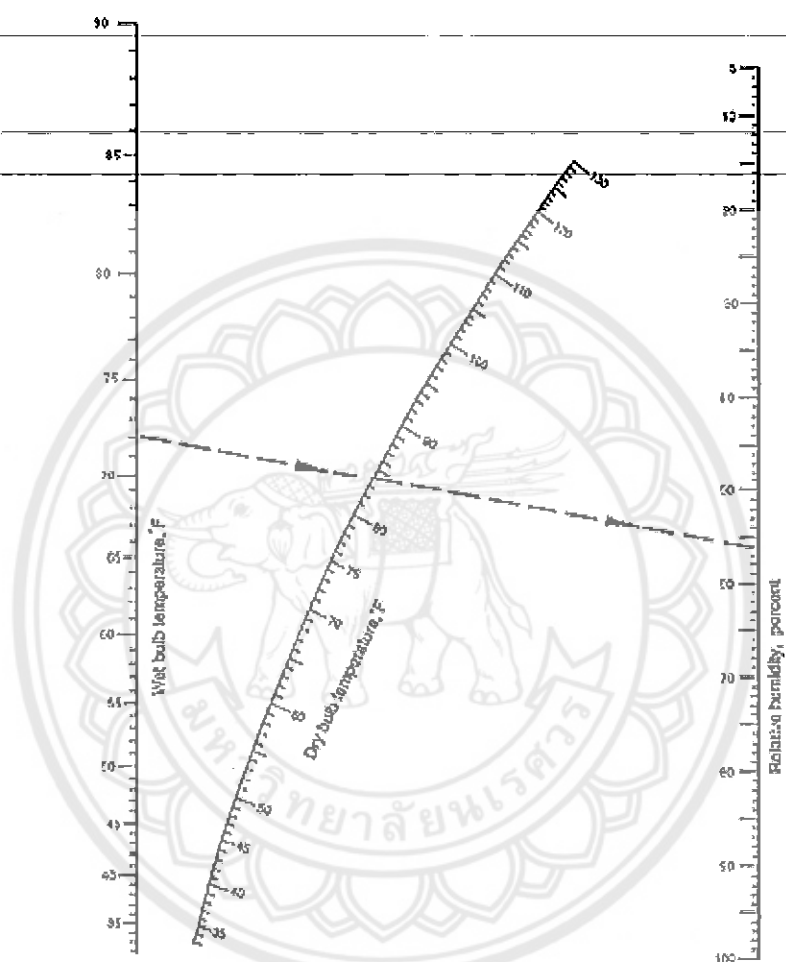
หมายถึง “อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ ปริมาณไอน้ำที่จะทำให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน” หรือ “อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว” ค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของร้อยละ (%)

วิธีที่แพร่หลายในการหาความชื้นสัมพัทธ์เรียกว่า วิธีวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง เราใช้เทอร์โมมิเตอร์จำนวนสองตัว ตัวแรกสำหรับวัดอุณหภูมิของอากาศแห้งตามธรรมดา อีกตัวหนึ่งจะถูกหุ้มห่อด้วยวัสดุขุ้มน้ำ และหล่อไว้ด้วยน้ำ

เมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ น้ำจะสามารถระเหยกลายเป็นไอน้ำได้มากและ ซึ่งอัตราการระเหยที่เร็ว นี้ จะทำให้อุณหภูมิจึงของกระเปาะเปียกต่ำกว่าอุณหภูมิจึงของกระเปาะแห้งมาก ในขณะที่หากความชื้นในอากาศสูงมากขึ้น อัตราการระเหยการเป็นไอของน้ำในกระเปาะเปียกจะน้อยลง ทำให้น้ำพาความร้อนออกไปได้น้อยลง ผลก็คือความแตกต่างของอุณหภูมิของกระเปาะทั้งสองจะน้อยลง และเมื่อใดที่ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเป็น 100% อัตราการระเหยของน้ำใน

กระเปาะเปียกจะเป็นศูนย์ด้วย ทำให้ไม่มีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งทั้งสอง

เมื่อเราทราบอุณหภูมิของกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งแล้ว เราสามารถหาความชื้นสัมพัทธ์ได้จากการเทียบกับชาร์ตที่เรียกว่า โนโมกราฟ (Nomograph) หรือ ไฮโคเมตริกชาร์ต (Psychrometric chart) โดยที่การหาจากโนโมกราฟจะสะดวกรวดเร็วกว่าในกรณีนี้

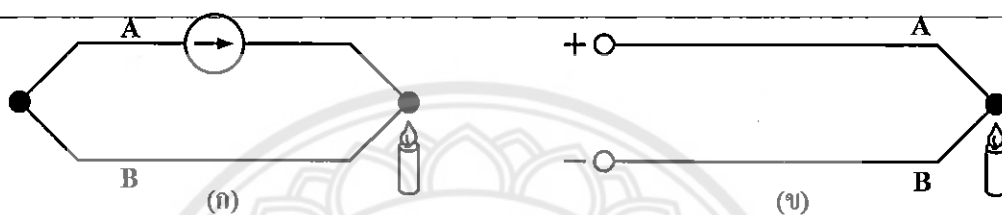


รูปที่ 2.1 โนโมกราฟและการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้โนโมกราฟแสดงในรูปข้างล่าง สมมติว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกเป็น 22.2 °C (72 °F) และอุณหภูมิกระเปาะแห้งเป็น 28.8 °C (84 °F) จะหาความชื้นสัมพัทธ์ได้เป็น 56%

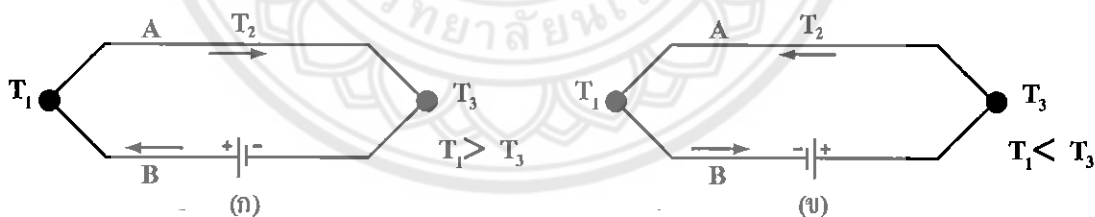
2.2 ความเป็นมาของเพลเทียร์

ในปี ค.ศ. 1821 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน Thomas Seebeck ทำการศึกษาพบว่าเมื่อนำขดลวดโลหะ 2 เส้นที่ทำด้วยโลหะต่างชนิดกันมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน ถ้าปลายจุดต่อทั้งสองมีอุณหภูมิต่างกัน จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรขดลวดทั้งสองแสดงดังรูปที่ 2.2 (ก) ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามผลต่างอุณหภูมิที่ปลายจุดต่อทั้งสอง และถ้าเปิดปลายจุดต่อด้านหนึ่งออกจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ปลายด้านเปิดแสดงดังในรูปที่ 2.2 (ข) แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้เรียกว่า “ซีเบ็ค โวลต์เตจ”



รูปที่ 2.2 การเกิดซีเบ็ค โวลต์เตจ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1834 Jean C.A. Peltier พบว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวงจรลักษณะเดียวกับซีเบ็คสร้างขึ้น โดยใช้ลวดด้านหนึ่งทำจากบิสมัทและอีกด้านหนึ่งทำจากแอนติโมนีจะทำให้เกิดอุณหภูมิที่ปลายจุดต่อแตกต่างกัน โดยปลายข้างหนึ่งจะร้อนและปลายอีกข้างหนึ่งจะเย็น วงจรการทดลองของเพลเทียร์เป็นแสดงดังรูปที่ 2.3



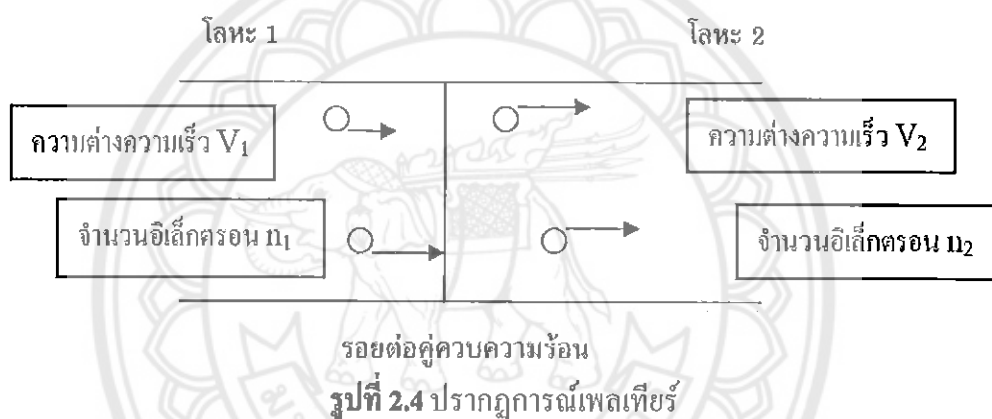
รูปที่ 2.3 วงจรการทดลองเพลเทียร์

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายนอกไหลผ่านเข้าไปในวงจรเป็นแสดงดังในรูปที่ 2.3 (ก) จะทำให้จุดต่อ T_1 มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดต่อ T_3 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายภายนอกไหลผ่านเข้าไปในวงจรเป็นแสดงดังในรูปที่ 2.3 (ข) จะทำให้จุดต่อ T_3 มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดต่อ T_1 ซึ่งจากการค้นพบของซีเบ็คและ เพลเทียร์ทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทอร์โมอิเล็กทริกต่อมา

2.3 หลักการทำงานของอุปกรณ์เพลเทียร์ (Peltier)

2.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปกรณ์เพลเทียร์

อุปกรณ์ทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่ใช้กันอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางด้านโซลิตสแตตที่สามารถปั๊มความร้อนออกจากพื้นผิวได้รวดเร็วโดยหลักการนี้เหมาะสำหรับการทำความเย็นให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น ใช้ทำความเย็นให้กับอุปกรณ์ตรวจจับคู่ควบประจุ หรือ CCD (Charge Coupled Device sensors) โฟโอดีไดโอดและอุปกรณ์กำเนิดแสงเลเซอร์ที่ผลิตจากหลักการสารกึ่งตัวนำโดยหลักการทำงานดังกล่าวใกล้เคียงกับปรากฏการณ์ซีเบค (Seebeck effect) กล่าวคือเมื่อเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างขั้วต่อ 2 ขั้ว ก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic field) เหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนและความเย็นที่แตกต่างกันระหว่างขั้วทั้งสอง นั่นก็คือหลักการของคู่ควบความร้อน (thermocouple)



จากรูปที่ 2.4 แสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ข้ามรอยต่อโลหะซึ่งมีพลังงาน 2 ฟังแตกต่างกัน ทำให้เกิดความร้อนหรือความเย็นก็ได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า แต่โดยปกติปรากฏการณ์นี้จะใช้ในการสร้างความเย็นมากกว่า

วิธีการของปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier) ก็คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ P - N ผลที่ได้ทั้งความร้อนและความเย็นที่บริเวณรอยต่อจะขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า ดังแสดงหลักการทำงานพื้นฐานไว้ดังรูปที่ 1 โดยแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนได้ไหลจากซ้ายข้ามไปทางขวา ตัดผ่านรอยต่อโลหะไป โดยสนามไฟฟ้า E_1 เป็นค่าแสดงคุณสมบัติของโซลิตสแตตว่ามีพลังงานเฉลี่ยของโลหะที่ 1 เป็นเท่าไร ส่วนค่าสนามไฟฟ้า E_2 ก็เช่นเดียวกัน จะแสดงคุณสมบัติของโลหะที่ 2 ดังนั้นอิเล็กตรอนในโลหะที่ 1 จะมีพลังงานในการเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อเท่ากับ

$$E_m = n_1 E_1 v_1 \quad (2.1)$$

พลังงานเฉลี่ยที่เอาที่พุดออกจากรอยต่อเท่ากับ

$$E_{out} = n_2 E_2 v_2 \quad (2.2)$$

โดยที่ E_{in}, E_{out}	คือพลังงานอินพุตและพลังงานเอาที่พุด ตามลำดับ
E_1, E_2	คือสนามไฟฟ้าที่โลหะ 1 และ 2 ตามลำดับ
n_1, n_2	คือจำนวนของอิเล็กตรอนฝั่งโลหะที่ 1 และ 2 ตามลำดับ
v_1, v_2	คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนฝั่งโลหะที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

และจากสมการกระแสไฟฟ้า (I) ที่ไหลผ่านรอยต่อก็จะมีค่าเท่ากับ

$$I = n_1 \times v_1 \times q = n_2 \times v_2 \times q \quad (2.3)$$

โดยที่ q คือประจุไฟฟ้า และ I คือกระแสไฟฟ้า โดยสรุปแล้วจะได้ผลรวมของพลังงานความร้อนที่บริเวณรอยต่อมีค่าเท่ากับ

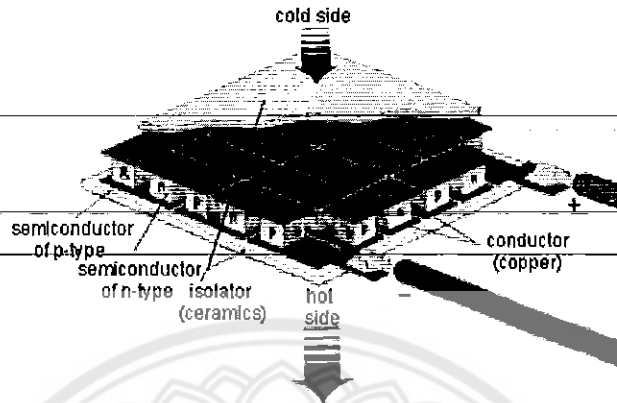
$$E_{out} - E_{in} = I / P (E_1 - E_{out}) \quad (2.4)$$

จากสมการแสดงให้เห็นได้ว่า ความร้อนที่ถูกดึงออกด้วยอุปกรณ์เพลเทียร์ จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสไฟฟ้าและผลต่างของสนามไฟฟ้าที่โลหะที่ 1 และ 2

ปรากฏการณ์เพลเทียร์นี้จะขึ้นอยู่กับโลหะทั้งสองฝั่งซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวผลของการสะสมทางความร้อนจะขึ้นอยู่กับค่าความเหนี่ยวนำของอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลงข้ามรอยต่อของโลหะดังกล่าวผลตอบสนองด้านความร้อนของปรากฏการณ์นี้กับโลหะธรรมดา เช่น เหล็ก หรือทองแดงนั้น จะมีผลตอบสนองน้อยมากและยากแก่การวัดค่าได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วต้องการความร้อนสูงมาก เพื่อนำไปใช้งาน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนจากโลหะธรรมดาเป็นสารกึ่งตัวนำ ซึ่งจะให้ผลตอบสนองสูงมาก อีกทั้งนำไปใช้งานได้ทั้งความเย็นและความร้อน ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสไฟฟ้า

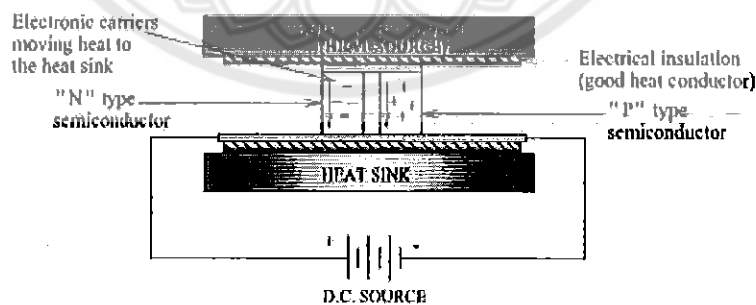
อุปกรณ์ทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก จะประกอบด้วยแผงรอยต่อ P-N วางเรียงกันระหว่างแผ่นเพลตเซรามิกตัวนำทั้ง 2 เพลต เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพลตด้านแรกผ่านรอยต่อ P-N ความเย็นก็จะถูกสะสมที่เพลตนั้น ส่วนความร้อนจะส่งผ่านไปยังรอยต่อ P-N คู่เพลตอีกด้านหนึ่ง ทำให้เพลตอีกด้านมีความร้อนสะสมอยู่สูง โดยความร้อนจะถูกดูดกลืนที่เพลตด้านไบแอสกลับ (reverse biased junction) ส่วนด้านไบแอสตรง (forward biased) จะเป็นด้านปล่อยความร้อนแทน

สารกึ่งตัวนำที่นำมาใช้จึงจำเป็นต้องมีช่องว่างแบนด์ (band gap) แคบ โดยปกติจะใช้สารบิสมัทเทลลูไรด์ (bismuth telluride) เพื่อที่จะได้ผลผลิตพาหะส่วนน้อย (minority carriers) เพียงพอ ณ อุณหภูมิปกติ



รูปที่ 2.5 การจัดเรียงตัวของ P-N Junction ภายในตัวเพลเทียร์

ในทางกลับกัน ถ้าจะประยุกต์นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานเป็นตัวทำความร้อนก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่ใช้งานในเฟลตตรงข้ามเท่านั้นเอง แต่ยังคงต้องพยายามรักษาอุณหภูมิต่างๆ ให้คงที่ ถึงแม้อุณหภูมิลรอบข้างจะเปลี่ยนแปลงไป สูงต่ำตามค่าที่ตั้งไว้ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานพื้นผิวเฟลตทางด้านเย็นจะถูกนำไปใช้เป็นตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก โดยจะต่อเข้ากับแผงควบคุมความเย็น ส่วนเฟลตทางฝั่งตรงข้ามที่เป็นเฟลตความร้อนนั้น มักจะต่อเข้ากับแผ่นระบายความร้อน (Heat sink) เพื่อระบายความร้อนด้วยอากาศขึ้นอยู่กัลักษณะการนำไปประยุกต์ใช้งานว่าจะทำความเย็นหรือความร้อน

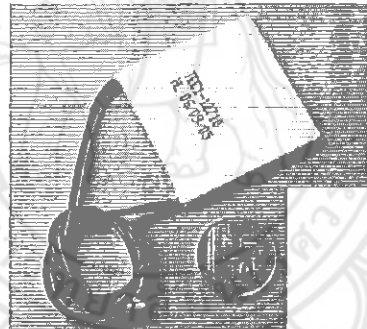


รูปที่ 2.6 ลักษณะของการส่งผ่านพลังงานความร้อนระหว่างเฟลตร้อนกับเฟลตเย็น

พารามิเตอร์ 2 ตัวที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกก็คืออุณหภูมิสูงสุดที่อุปกรณ์ยังสามารถคงอยู่ได้และความร้อนที่ป้อนเข้าไป ความแตกต่างของอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ต้องเป็นค่าที่ไม่มีไหลลดความร้อนจากภายนอกบนเฟลตความเย็นดังนั้นจะเห็นได้ว่าพลังงานไฟฟ้าอินพุตทั้งหมดที่ส่งเข้าไปยังตัวทำความเย็นจะถูกใช้เอาชนะพลังงานความ

ร้อนภายในที่รั่วไหลออกมาจะใช้ในการต่อต้านความร้อนที่แพร่ทะลุผ่านเพดความเย็นยิ่งรั่วมาก ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นก็จะลดลงด้วย

อุณหภูมิระหว่างเพดทั้งสองจะแตกต่างกันมากที่สุด โดยวิธีการนำเพดความร้อนไปใส่ไว้ในสถานะสุญญากาศ และใส่ไนโตรเจนแห้งเข้าไปด้วยในสภาพสุญญากาศนี้จะเป็นการกำจัดการแพร่กระจายของความร้อนดังนั้นความร้อนภายในจึงไม่สามารถรั่วออกมาได้ ทำให้ได้เพดความเย็นที่มีความเย็นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเพดความร้อนความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเพดทั้งสองจะอยู่ระหว่าง 60 ถึง 70 °C ที่สถานะสุญญากาศผสมไนโตรเจนแห้ง ถ้าจะใช้โดยให้มีอุณหภูมิมากกว่านี้สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ชนิดหลายชั้น (multistage) ลักษณะจะคล้ายปิรามิด โดยเพดความร้อนของชั้นบนก็คือเพดความเย็นของชั้นล่างที่อยู่ติดกัน-การใช้จะลดอุณหภูมิลงมาตามชั้นพิจารณาเพดความเย็นของชั้นบนสุดกับเพดความร้อนของชั้นต่ำสุดผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนมีเพดแค่ 2 เพดที่เสมือนเป็นเทอร์โมอิเล็กทริกชั้นเดียวแต่จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเพดสูงกว่าชนิดชั้นเดียว เช่น อุปกรณ์ชนิดสามชั้นจะมีอุณหภูมิต่างกันสูงสุด 100°C แต่อุปกรณ์ชนิดหกชั้นมีอุณหภูมิต่างกันสูงสุดแค่ 130 องศาเซลเซียสเท่านั้นและจากตัวอย่างของอุปกรณ์เพดเทียร์ที่ใช้งานกันทั่วไปได้แสดงดังรูป



รูปที่ 2.7 ลักษณะรูปร่างของเพดเทียร์ที่ใช้งานกันทั่วไป

พิจารณาปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะเห็นว่าตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถออกแบบได้หลายชนิด เช่น ชนิดไร้รอยต่อ P-N Junction ขนาดเล็กๆหลายๆรอยต่อ หรืออาจใช้ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รอยต่อก็ได้ ก็สามารถให้คุณสมบัติทางความร้อนและขนาดความหนาบางเท่าเดิม แต่ราคาแบบหลังจะราคาถูกลงกว่าและแข็งแรงกว่าด้วย

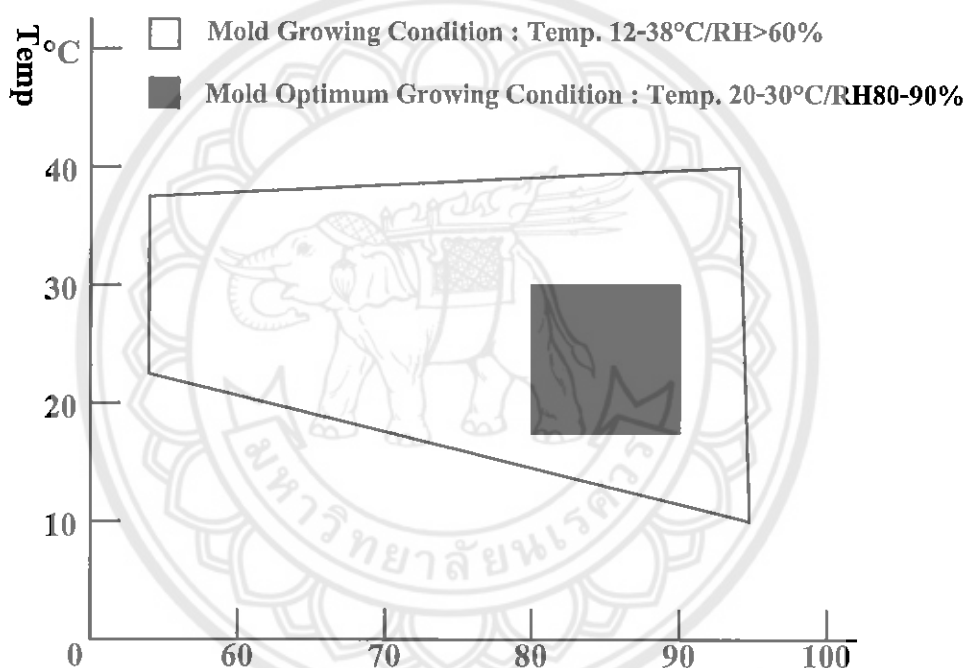
เนื่องจากอุปกรณ์เพดเทียร์มีค่าความต้านทานต่ำมาก ดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ประกอบจึงทำได้ยาก และการออกแบบจะต้องคำนึงเสมอว่าจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ด้วยหรือไม่

การติดตั้งอุปกรณ์เพดเทียร์ พื้นฐานของตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีลักษณะที่ประาะบางแตกง่ายและราคาแพง ดังนั้นแผ่นระบายความร้อนจึงควรมีลักษณะบางแบนราบ และตัวถังต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องรับแรงกดจากภายนอก ดังนั้นอุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งเข้ากับสาย

ที่ต่อเชื่อมเข้ากับเพลตความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนรั่วไหลออก ส่วนตัวถังต้องวางไม่ให้เกิดแรงเครียดหรือแรงดันใดๆ และถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส จะต้องเชื่อมรอยต่อ P-N เข้าด้วยกันด้วยลวดเชื่อมพิเศษจุดเชื่อมจะเล็กมากและละเอียดไม่ทำอันตรายกับพื้นผิวบริเวณรอยต่อ

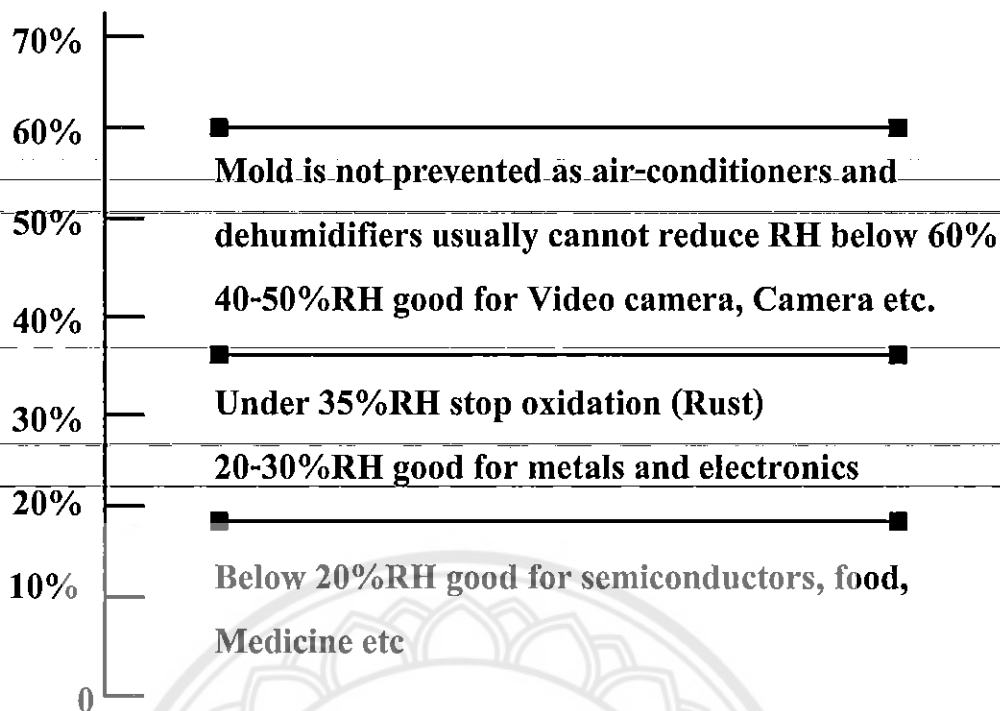
2.4 เชื้อราและการเก็บรักษาอุปกรณ์

เชื้อราเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานน้อยลง โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตคือ ความชื้น หากว่าพื้นที่ที่มีความชื้นมากย่อมทำให้เชื้อรามีการเจริญเติบโตได้มากเช่นกัน ดังนั้น การลดควบคุมความชื้นจึงเป็นวิธีหนึ่งในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อรา



รูปที่ 2.8 กราฟการเจริญเติบโตของเชื้อรา [10]

จากกราฟดังรูปที่ 2.9 จะเห็นได้ว่าเมื่อความชื้นมีค่ามากกว่า 60% จะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ เมื่อความชื้นยิ่งมากเชื้อรายิ่งทำให้การเติบโตของเชื้อรามากขึ้นด้วย ดังนั้น การควบคุมความชื้นให้มีค่าต่ำกว่า 60% จะสามารถเก็บรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือส่วนใหญ่ได้ แต่อุปกรณ์บางชนิด เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นั้นต้องการการเก็บรักษาที่มีความชื้นต่ำมาก เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความเปราะบางและเสียหายง่าย ดังนั้นการเก็บรักษาอุปกรณ์แต่ละชนิดย่อมมีความแตกต่างกัน



รูปที่ 2.9 ช่วงที่เหมาะสมต่อการควบคุมความชื้นให้แก่อุปกรณ์ชนิดต่างๆ [10]

ตารางที่ 2.1 การจัดการควบคุมความชื้นที่อุณหภูมิปกติ, ความชื้นต่ำ [10]

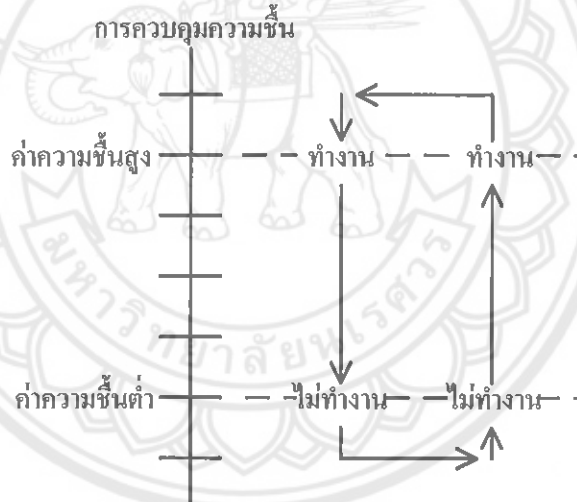
HUMIDITY	Suitable Article
40%RH ~ 50%RH	กล้องวิดีโอ, กล้องถ่ายรูป, เลนส์, กล้องจุลทรรศน์, ฟิล์ม, อุปกรณ์เกี่ยวกับดวงตา, คอมพิวเตอร์, สเตอริโอ, ซีดีและวีซีดี, หนังสือ, ภาพวาด, แสตมป์ ฯลฯ
30%RH ~ 40%RH	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, พีซีบี, Indicator, เครื่องดนตรี, หนังสือตัว, ทองและเงิน, ของสะสมและของมีค่าต่างๆ
Under 30%RH	สมุนไพร, โบชา, เมล็ดพืช, เครื่องเทศ, ยา, วัสดุแบบผง, อุปกรณ์ทางเคมี, อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

บทที่ 3

การออกแบบ

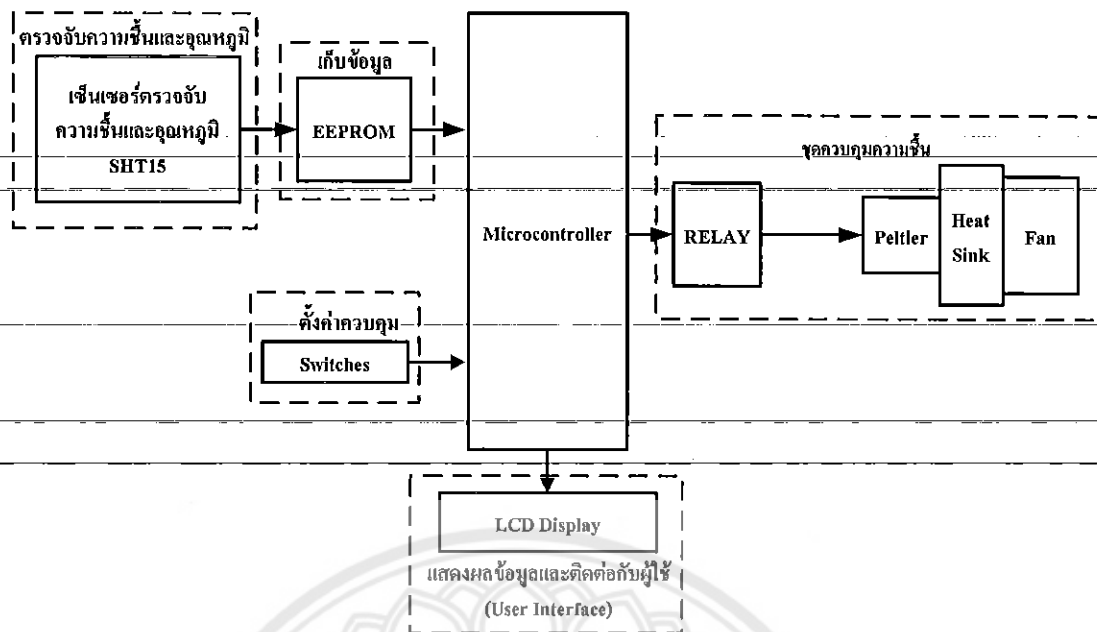
3.1 แนวคิดในการออกแบบ

สำหรับระบบควบคุมความชื้นนี้จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 ของบริษัท ATMEL โดยได้เลือกไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89C2051 เป็นหัวใจหลักในการควบคุมการทำงานทั้งหมด ซึ่งระบบควบคุมนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคุมอุณหภูมิได้อีกด้วยเนื่องจากระบบควบคุมนี้ใช้เซ็นเซอร์ ของบริษัท SENSIRION รุ่น SHT15 ที่มีคุณสมบัติตรวจจับได้ทั้งความชื้นและอุณหภูมิ ดังนั้นจึงสามารถตั้งค่าความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำได้ เพื่อใช้ควบคุมค่าเหล่านั้นให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ระบบจะแยกชุดควบคุมความชื้นและชุดควบคุมอุณหภูมิไว้คนละส่วน



รูปที่ 3.1 การทำงานของการควบคุมความชื้น

จากรูปที่ 3.1 จะเห็นได้ว่าเมื่อความชื้นมีค่าสูงกว่าค่าความชื้นสูงที่ตั้งไว้ ชุดควบคุมความชื้นก็จะทำงานจนกระทั่งความชื้นลดต่ำลงเท่ากับหรือต่ำกว่าค่าความชื้นที่ตั้งไว้ ชุดควบคุมความชื้นก็จะหยุดทำงาน วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ

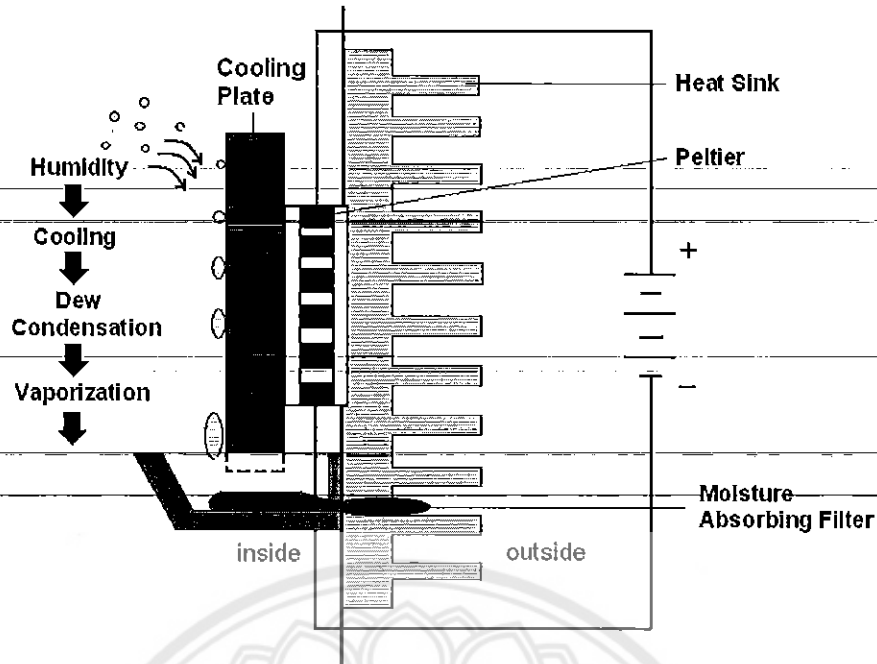


รูปที่ 3.2 Block Diagram ของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Microcontroller

เมื่อพิจารณาจาก Block Diagram ดังรูปที่ 3.2 จะเป็นภาพการทำงานโดยรวมของระบบ ซึ่งเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ จะส่งข้อมูลไปยัง EEPROM ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลของเซ็นเซอร์ แล้วส่งไปประมวลผลที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถตั้งค่าควบคุมได้โดยใช้สวิตช์ จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะแสดงผลออกทาง LCD Display และในกรณีที่ค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นมีค่าสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งการให้ชุดควบคุมอุณหภูมิและชุดควบคุมความชื้นทำงาน โดยผ่านการ Relay

3.1.1 การใช้อุปกรณ์เพลเทียร์ควบคุมความชื้น

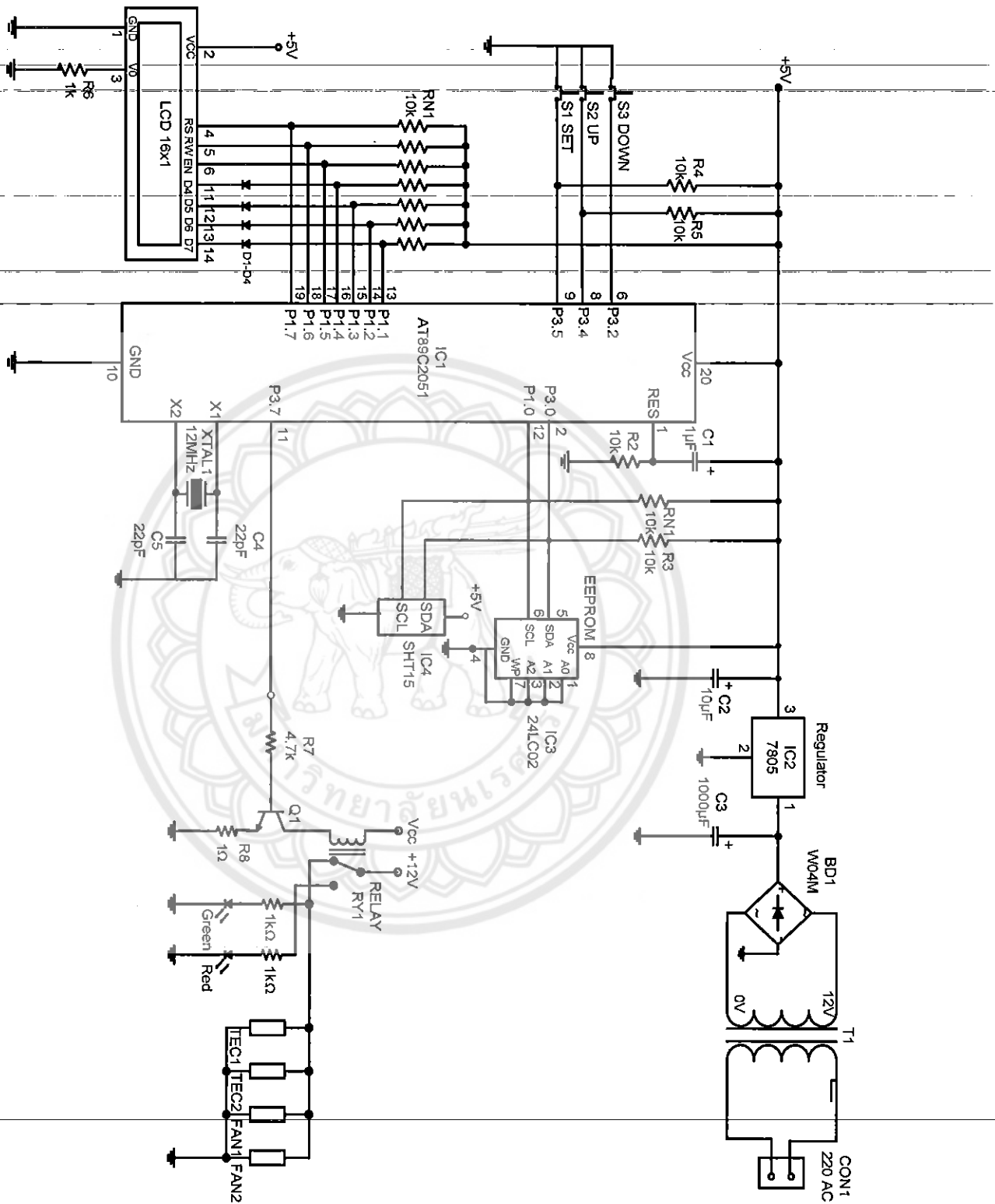
ความชื้นเป็นตัวแปรทางด้านกายภาพ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆที่เราสนใจซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทดลองเองหรือในระบบอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องควบคุมและสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเหล่านี้ ซึ่งเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบ รวมทั้งความชื้น ซึ่งผลที่ได้จากเซ็นเซอร์ สามารถนำมาควบคุมการทำงานของระบบได้ โดยผ่านการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ



รูปที่ 3.3 หลักการควบคุมความชื้นของอุปกรณ์เพลเทียร์

จากรูปที่ 3.3 เมื่อจ่ายกระแสให้กับเพลเทียร์จะทำให้เพลต์ด้านหนึ่งเย็น อีกด้านหนึ่งร้อน ซึ่งด้านที่เย็นนั้นจะใช้เพลต์ที่มีหน้าสัมผัสที่กว้างกว่าเพลเทียร์เพื่อใช้ในการเพิ่มพื้นที่ผิวกระจายความเย็น ส่วนด้านร้อนจะถูกระบายความร้อนออกด้วย Heat sink เมื่อมีความชื้นมากกว่าค่าที่ได้ตั้งไว้ เพลเทียร์ด้านเย็นจะทำงาน และจะเป็นตัวจับไอน้ำในอากาศให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำแล้วไหลลงสู่แผ่นกรองความชื้นที่ใช้ระบายความชื้นออกไปด้านนอก ทำให้ได้ค่าความชื้นอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้

3.2 การออกแบบวงจร



รูปที่ 3.4 วงจรควบคุมความชื้นที่ออกแบบ

3.2.1 การทำงานของวงจร

จากวงจรที่ใช้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแสดงดังรูปที่ 3.4 หัวใจหลักของวงจรจะอยู่ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89C2051 ซึ่งเป็นไอซีที่ใช้สำหรับบรรจุโปรแกรมการทำงานของวงจรทั้งหมด โดยที่การทำงานของวงจรจะเริ่มขึ้นที่ภาคจ่ายไฟเป็นอันดับแรก แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 12 โวลต์ จากหม้อแปลงที่ป้อนเข้ามาจะถูกเรกติไฟด์ (Rectified) โดย บริดจ์ไดโอด (BD1) เพื่อเรียงไฟกระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรง 12 โวลต์ และถูกลดแรงดันที่เหลือ 5 โวลต์ โดยไอซีเรกูเลเตอร์ 7805 โดยจะมีตัวเก็บประจุ C2 และ C3 เป็นตัวช่วยในการกรองแรงดันให้เรียบ

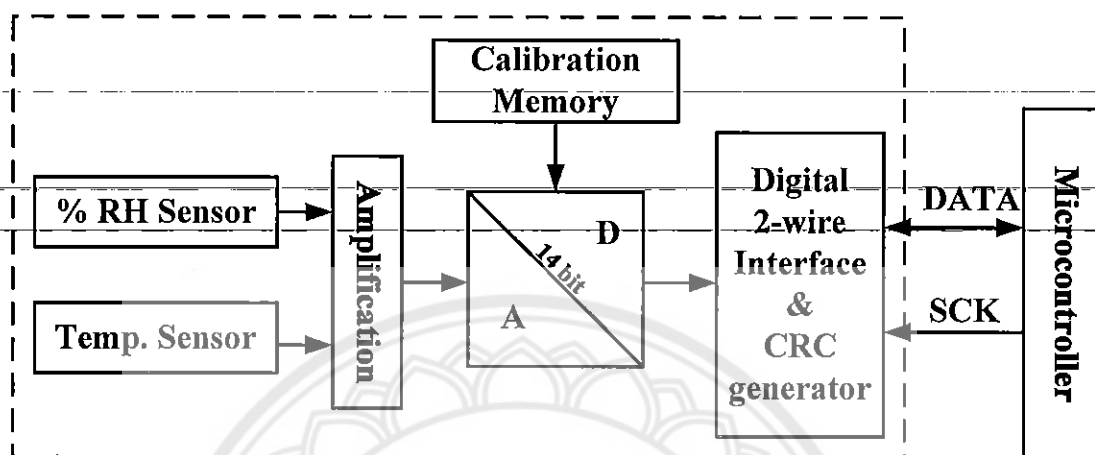
ในส่วนการใช้งาน LCD ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้แสดงผล เป็นการต่อขาใช้งานในโหมด 4 บิต ซึ่งจะเห็นว่าขาข้อมูลจะถูกใช้เพียง 4 เส้นเท่านั้น คือขา D4-D7 โดยมีไดโอด D1-D4 เป็นตัวเรียงกระแสให้ข้อมูลผ่าน โมดูล LCD อย่างถูกต้อง ส่วนขาควบคุม โมดูล LCD นั้น จะมีอยู่ 3 ขา นั่นคือ ขา EN ทำหน้าที่สั่งการอื่นาเปิด โมดูล LCD ส่วนขา RW ทำหน้าที่เลือกการอ่านหรือเขียนข้อมูลลงยังโมดูล LCD และสุดท้าย ขา RS ทำหน้าที่เลือกชนิดของข้อมูลหรือคำสั่งที่จะเขียนให้กับ โมดูล LCD ในด้านการแสดงผลของ LCD จะมีตัวต้านทาน R6 ทำหน้าที่จำกัดความสว่างของหน้าจอไว้ หากว่าใช้ R6 ที่มีค่าความต้านทานน้อยๆ หน้าจอก็จะสว่างมาก หากใช้ค่าความต้านทานมาก ความสว่างก็จะน้อยลง

ส่วนของหน่วยความจำ EEPROM ใช้ไอซีเบอร์ 24LC02 (IC3) ใช้เป็นส่วนเก็บค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่เก็บไว้หายไปหลังจากปิดเครื่อง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อปิดเครื่องขึ้นมา ค่าต่างๆที่เคยเซตไว้จะยังคงอยู่ โดยไอซี 24LC02 ที่ใช้ในวงจรนี้เป็นไอซีที่ใช้วิธีการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรม 8 บิต ด้วยการเชื่อมต่อผ่านระบบบัส I2C โดยใช้ขาสัญญาณเพียง 2 เส้น คือ ขา SCL (ขาสัญญาณนาฬิกา) ซึ่งในที่นี้ถูกต่อเข้ากับพอร์ต P1.0 ส่วนขา SDA (ขาสัญญาณข้อมูล) จะต่อเข้ากับพอร์ต P3.0 ซึ่งข้อดีของการใช้หน่วยความจำแบบ EEPROM ในการเก็บรักษาข้อมูลคือ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แบ็กอัพข้อมูลเหมือนหน่วยความจำ RAM

ในส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น SHT15 (IC4) มีขาใช้งานอยู่ด้วยกัน 4 ขา เหมือนกับ EEPROM การต่อขาใช้งานของ SHT15 จึงสามารถต่อขานานเข้ากับขาของ 24LC02 ได้เลย เนื่องจากอุปกรณ์สองตัวนี้ทำงานด้วยระบบบัส I2C เหมือนกันทั้งคู่ ส่วนสวิตช์กดติดปลั๊กคียบ S1, S2 และ S3 มีไว้สำหรับตั้งค่าความชื้นที่ต้องการ โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับลอจิก '1' ที่ได้มาจากการกดสวิตช์แต่ละตัว เข้ามายังพอร์ต P3.5, P3.4 และ P3.2 เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป

ส่วนสัญญาณเอาต์พุตที่นำไปควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความชื้นนั้น จะต่อมาจากพอร์ต P3.7 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งไปป้อนให้กับรีเลย์ โดยที่รีเลย์ (RY1) ทำหน้าที่เป็นตัวตัดต่อไฟเลี้ยงของอุปกรณ์ควบคุมความชื้น โดยมีทรานซิสเตอร์ Q1 เป็นตัวขับให้รีเลย์ทำงาน

เมื่อพอร์ต P3.7 ส่งลอจิก '1' ไปไบอัสขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 จะทำให้หลอดไฟสีเขียวสว่าง และรีเลย์ RY1 ก็ทำงาน



รูปที่ 3.5 Block Diagram ของตัวตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิ SHT15

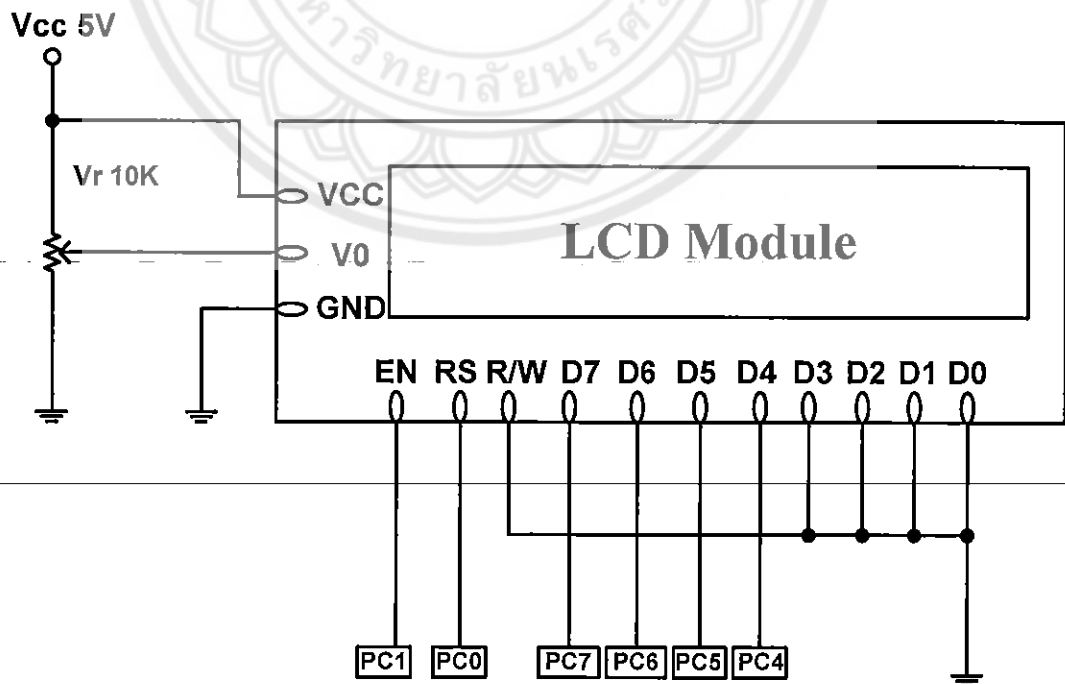
ในส่วนของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตัวตรวจจับความชื้นกับอุณหภูมิ SHT-15 กับ Microcontroller จะเป็นการเชื่อมต่อแบบอนุกรม (Serial Interface) ซึ่งตัวตรวจจับนี้จะทำการวัดค่าความชื้นด้วยตัวตรวจจับความชื้นและวัดค่าอุณหภูมิด้วยตัวตรวจจับอุณหภูมิ ซึ่งสองส่วนนี้จะอยู่บน SHT-15 ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งออกมาในระบบดิจิทัล ซึ่งจะมีหน่วยที่ใช้ในการแปลงจากสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล 14 บิต เราจึงต้องทำการออกแบบโปรแกรมที่สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างตัวตรวจจับและ Microcontroller ได้

3.2.2 LCD Module

การติดต่อกับ โมดูล LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัดมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ 8 บิต และ 4 บิต โดยโครงงานนี้ใช้วิธีการติดต่อกับจอแสดงผลเป็นแบบ 4 บิต โดยการต่อเป็นไปตามนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางชื่อและหน้าที่ของสัญญาณต่างๆของ LCD

ขาที่	ชื่อขา	หน้าที่การทำงาน
1	GND	ต่อกับกราวด์ของวงจร
2	+Vcc	ต่อกับไฟเลี้ยง 5.V
3	Vo	ป้อนแรงดันเพื่อปรับแสงสว่าง
4	Rs	เป็นขาเลือกการติดต่อกับรีจิสเตอร์คำสั่งหรือรีจิสเตอร์ข้อมูล 0 : จะติดต่อกับรีจิสเตอร์คำสั่ง 1: จะติดต่อกับรีจิสเตอร์ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปแสดงผล
5	R/W	ต่อลงกราวด์เพราะต้องการเขียนข้อมูลแสดงผลอย่างเดียว
6	E	เป็นขา Enable การทำงานให้ LCD
7-10	Do-D3	ต่อร่วมกันลงกราวด์เพราะใช้ 4 บิตหลัง
11-14	D4-D7	เป็นขาข้อมูล4บิต



รูปที่ 3.6 การต่อใช้งานจอแสดงผล LCD

• **การเขียนข้อมูลคำสั่งไปยังจอแสดงผล**

1. ทำให้ขา RS เป็น “0” เพื่อแจ้งให้จอแสดงผลทราบว่าข้อมูลที่ขา DATA เป็นข้อมูลคำสั่ง
2. ส่งข้อมูล (Data) 4 บิตบน (บิต7-บิต4) ที่ต้องการไปยังขา Data ทั้ง 4 เส้น
3. ส่งพัลส์ Enable ไปยังขา E
4. ส่งข้อมูลคำสั่ง 4 บิตล่าง (บิต3-บิต0) ที่ต้องการไปยังขา Data ทั้ง 4 เส้น
5. ส่งพัลส์ Enable ไปยังขา E

• **การเขียนข้อมูล (Data) ไปยังจอแสดงผล**

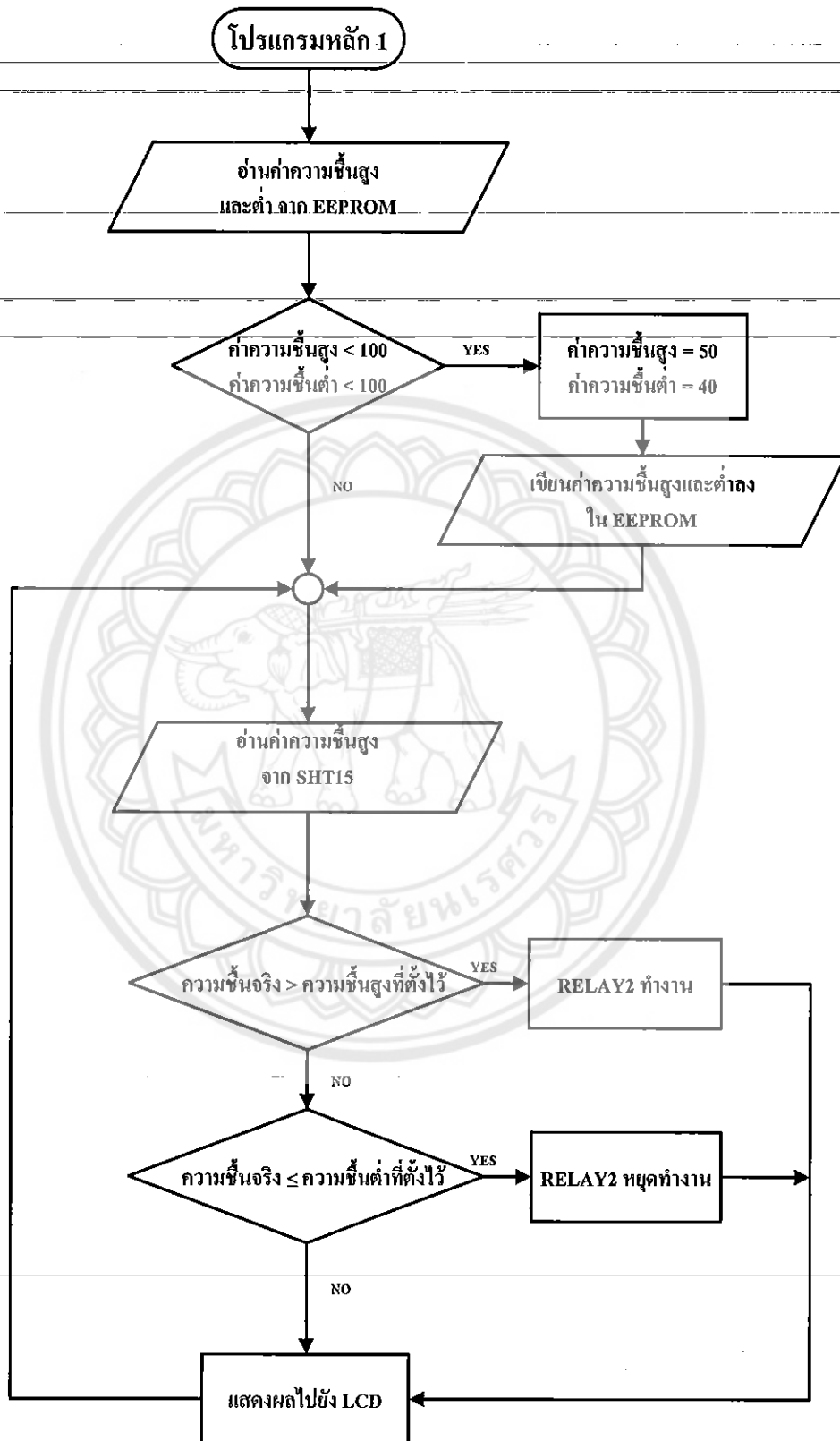
1. ทำให้ขา RS เป็น “1” เพื่อแจ้งให้จอแสดงผลทราบว่าข้อมูลที่ขา DATA เป็นข้อมูลในการแสดงผล
2. ส่งข้อมูล (Data) 4 บิตบน (บิต7-บิต4) ที่ต้องการไปยังขา Data ทั้ง 4 เส้น
3. ส่งพัลส์ Enable ไปยังขา E
4. ส่งข้อมูล (Data) 4 บิตล่าง (บิต3-บิต0) ที่ต้องการไปยังขา Data ทั้ง 4 เส้น
5. ส่งพัลส์ Enable ไปยังขา E

3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของวงจรควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือโปรแกรมคำสั่งนั้นจะอธิบายอยู่ในรูปของแผนภาพการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ซึ่งมีโปรแกรมย่อยต่างๆดังนี้

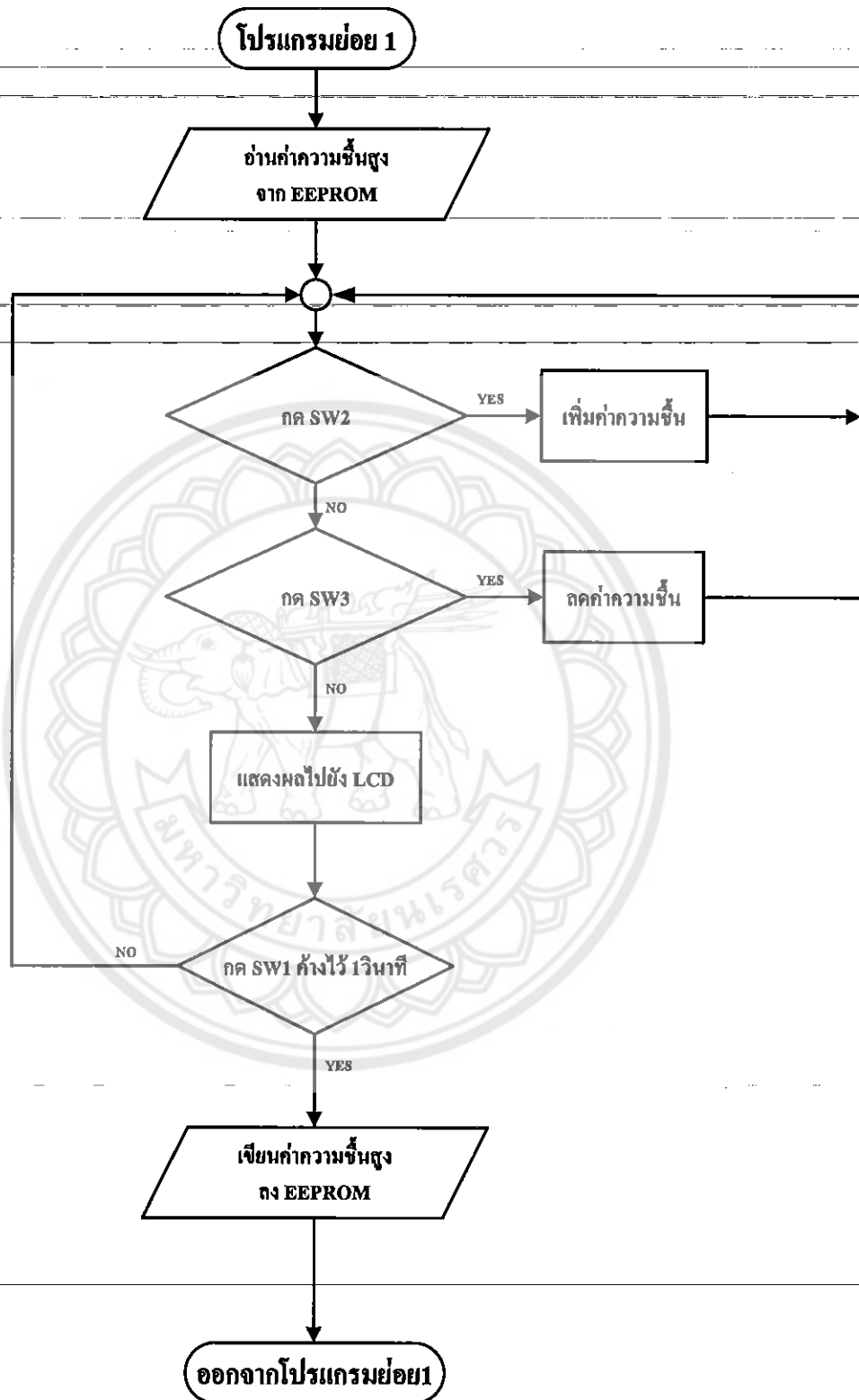
1. โปรแกรมหลัก 1 โปรแกรมหลักสำหรับควบคุมความชื้น
2. โปรแกรมย่อย 1 โปรแกรมย่อยสำหรับตั้งค่าความชื้นค่าสูง
3. โปรแกรมย่อย 2 โปรแกรมย่อยสำหรับตั้งค่าความชื้นค่าต่ำ

3.3.1 โปรแกรมหลัก 1 โปรแกรมหลักสำหรับควบคุมความชื้น



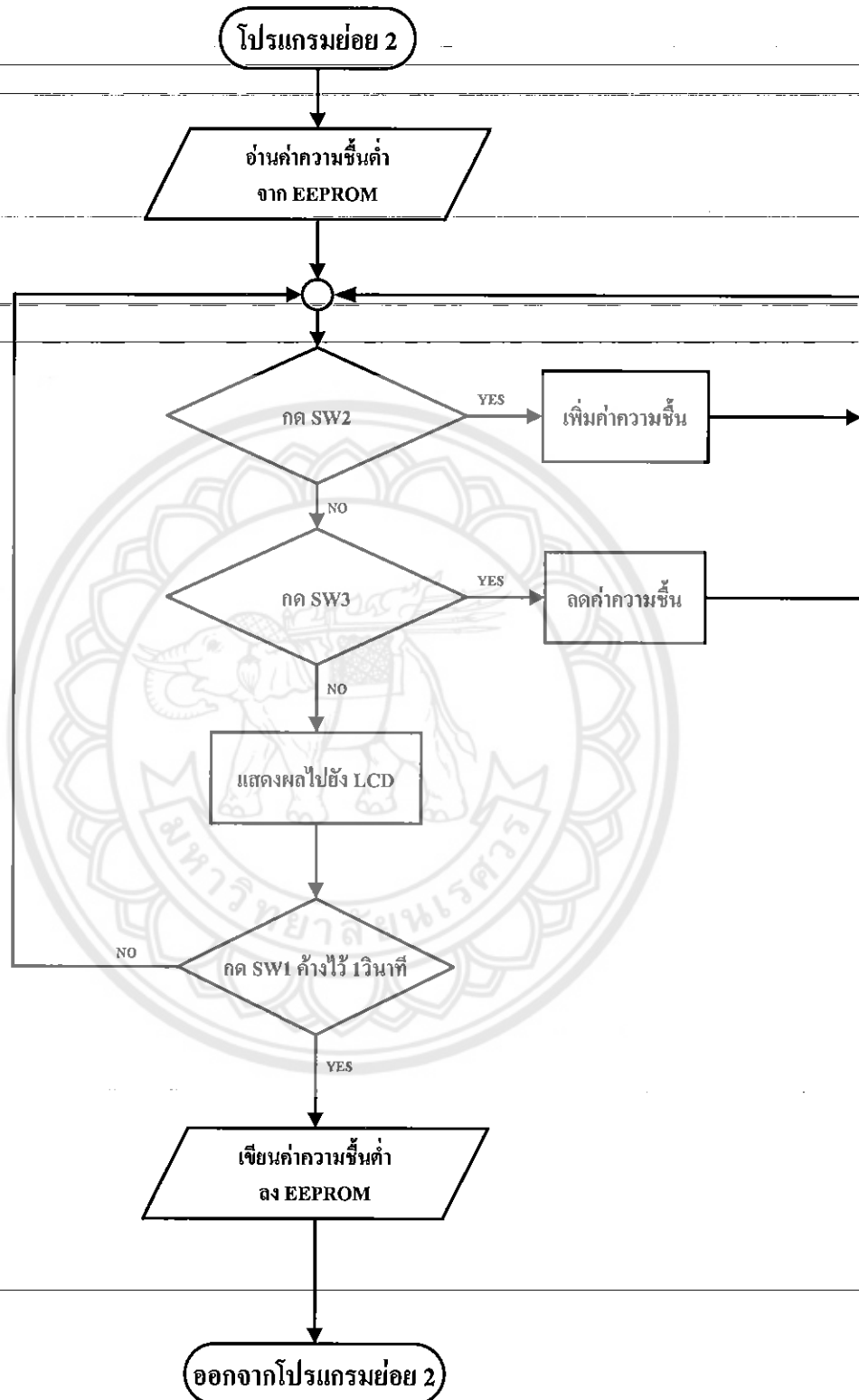
รูปที่ 3.7 แผนภาพโปรแกรมหลัก 1

3.3.2 โปรแกรมย่อยสำหรับตั้งค่าความชื้นค่าสูง



รูปที่ 3.8 แผนภาพ โปรแกรมย่อย 1

3.3.3 โปรแกรมย่อยสำหรับตั้งค่าความชื้นค่าต่ำ

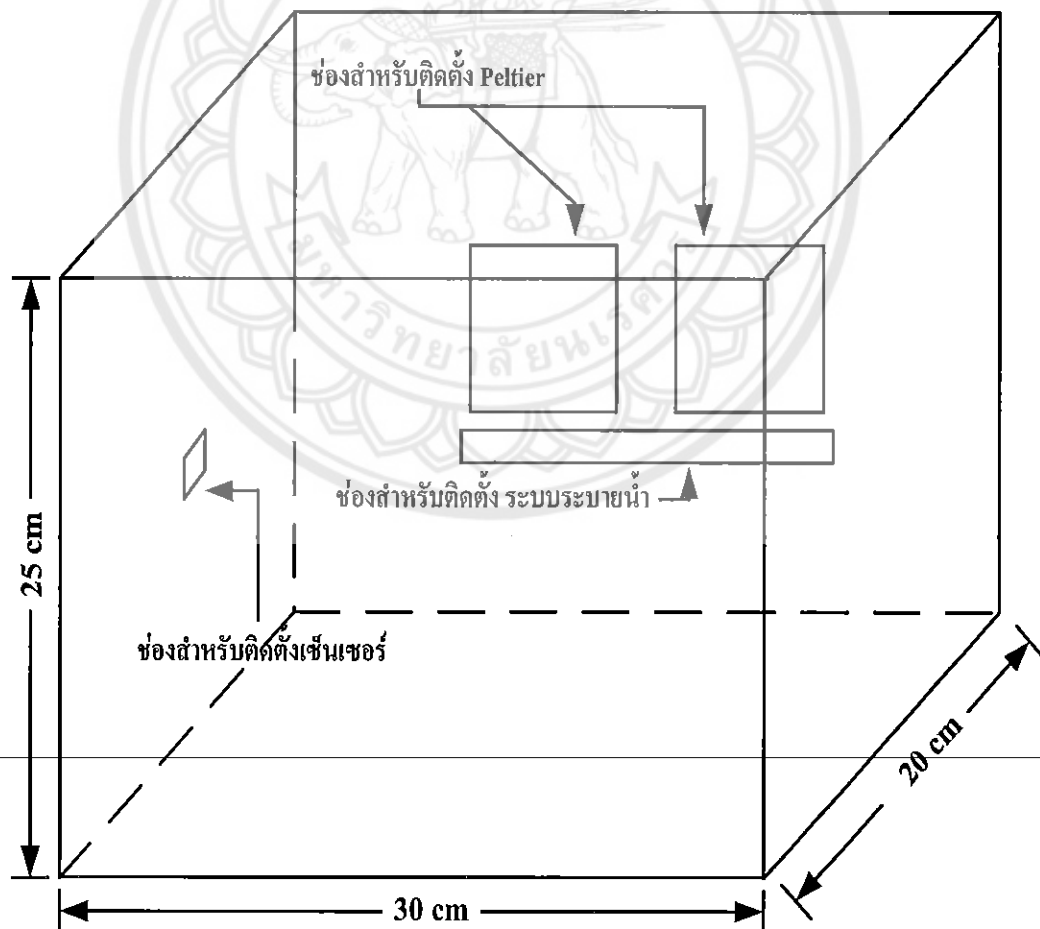


รูปที่ 3.9 แผนภาพ โปรแกรมย่อย 2

3.4 การออกแบบตู้ควบคุมความชื้น (Chamber)

ในการออกแบบตู้ที่ใช้ในการควบคุมความชื้นนั้น จะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่สำคัญ 2 ส่วนด้วยกันดังต่อไปนี้

3.4.1 โครงสร้างตู้ควบคุมความชื้น ใช้วัสดุพลาสติกแข็งทำเป็นห้องสี่เหลี่ยม ซึ่งแผ่นพลาสติกแข็งที่ใช้มีความหนาประมาณ 3-5 mm โดยที่ด้านหลังเจาะเว้นช่องสี่เหลี่ยมขนาด 7×7 cm ไว้จำนวน 2 ช่องสำหรับ Heat Sink ของทางด้านเพลทเย็น เพื่อใช้ในการควบคุมความชื้นภายในตู้ควบคุมความชื้นและช่องขนาด 15×2 cm เป็นช่องเพื่อใช้ติดตั้งระบบระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของอากาศที่ไหลลงมาจากเพลทเย็น ดังรูป



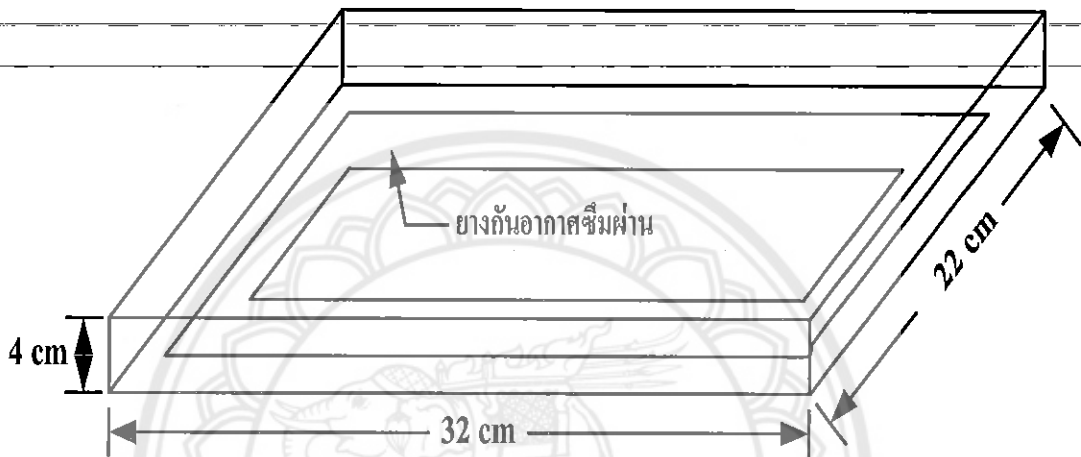
รูปที่ 3.10 โครงสร้างของตู้ควบคุมความชื้น

3.4.2 ฝาปิดตู้ ใช้วัสดุพลาสติกแข็งทำเป็นตัวฝา ส่วนขอบด้านล่างติดยางกันอากาศซึมผ่านออกจากตู้ควบคุมความชื้น ดังรูป

ร/ร.

11674 ๗

2550



รูปที่ 3.11 โครงสร้างฝาปิดตู้ควบคุมความชื้น

บทที่ 4

การปฏิบัติและการทดลอง

4.1 การสร้างวงจรควบคุมความชื้น

ทำการสร้างวงจรควบคุมความชื้น ซึ่งได้มาจากการศึกษาการควบคุมความชื้น แล้วนำมาสร้างเป็นวงจรควบคุมความชื้นแบบดิจิทัล



รูปที่ 4.1 วงจรควบคุมความชื้นที่ประกอบเสร็จแล้ว

โดยทำการบัดกรีอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของวงจร ลงบนแผ่นปริ๊นท์อเนกประสงค์ แล้วทำการทดสอบวงจร ซึ่งได้ผลการทดสอบดังนี้

- เมื่อจ่ายไฟเลี้ยง 12 VDC ให้กับวงจร ที่จอแสดงผล LCD จะแสดง "Humidity" อยู่ประมาณ 3 วินาที แล้วจึงอุณหภูมิกับความชื้น ซึ่งค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นนั้นคือค่าปกติที่วัดได้โดยรอบของเซ็นเซอร์

- กดปุ่ม SET ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที จะเป็นการเซตค่าความชื้นต่ำ
- กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งค่าความชื้นต่ำตามที่ต้องการ
- กดปุ่ม SET อีก 1 ครั้ง ที่ LCD จะแสดงค่าความชื้นสูงที่ต้องการเซต
- กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งค่าความชื้นสูงตามที่ต้องการ
- กดปุ่ม SET อีก 1 ครั้ง จะกลับไปแสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นตามปกติ

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของความชื้น ซึ่งถ้าหากความชื้นสูงกว่าที่ SET เอาไว้ LED จะเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีเขียว พร้อมทั้ง Relay จะเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC แต่ถ้าความชื้นต่ำกว่าที่ SET เอาไว้ LED จะเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีแดงตามเดิม พร้อมทั้ง Relay จะเปลี่ยนสถานะจาก NC เป็น NO แสดงว่าวงจรทำงานได้สมบูรณ์แบบ

4.2 การติดตั้งเพลทเทียร์

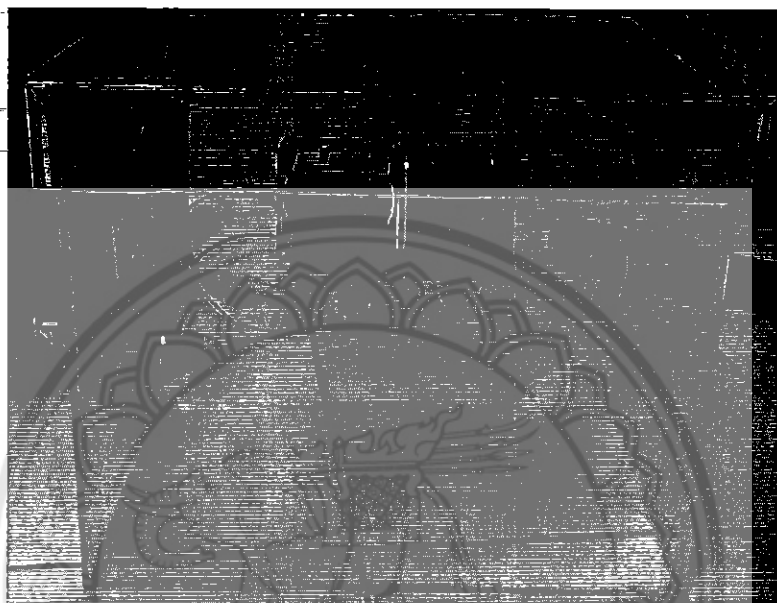
การติดตั้งเพลทเทียร์นั้น จะติดตั้งโดยให้ด้านร้อนติดกับ Heat Sink ใช้พัดลมระบายความร้อนให้ Heat Sink ด้วย ส่วนด้านเย็นของเพลทเทียร์จะติดกับแผ่นอลูมิเนียม เพื่อเป็นตัวจับไอน้ำในอากาศให้ควบแน่นเป็นหยดน้ำ ซึ่งทำให้ความชื้นลดลงได้



รูปที่ 4.2 การติดตั้งเพลทเทียร์เข้ากับ Heat Sink

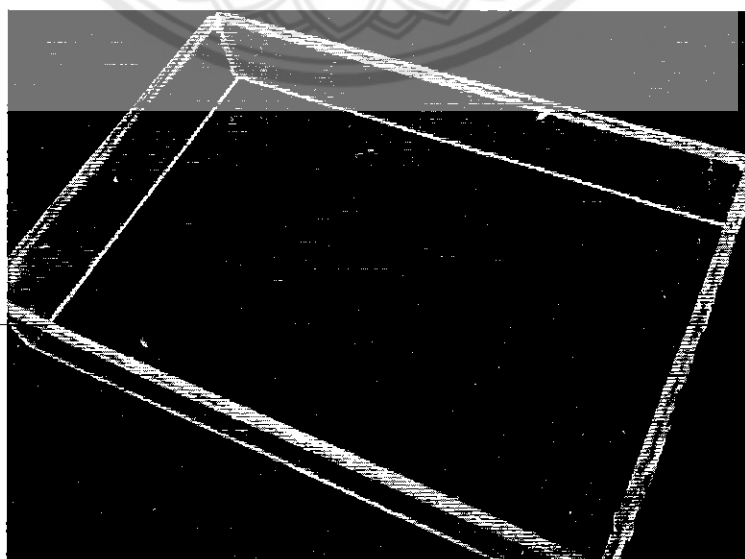
4.3 โครงสร้างของตู้ควบคุมความชื้น

หลังจากที่ได้ออกแบบตู้ควบคุมความชื้นมาแล้วนั้น จึงได้ทำการตัดแผ่นพลาสติกแข็ง ซึ่งเป็นวัสดุที่นำมาใช้สร้างตู้ควบคุมความชื้น ให้ได้ขนาดตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยที่ด้านข้างจะเจาะรูไว้เพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความชื้น และทางด้านหลังของตู้จะทำช่องไว้เพื่อใช้ติดตั้งเพลมเทียร์และชุดระบายความร้อน



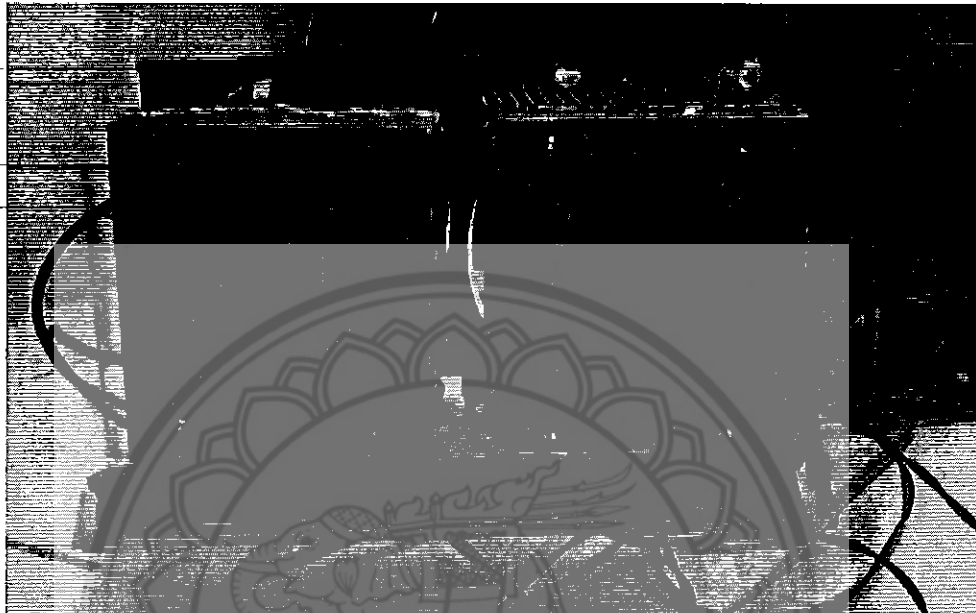
รูปที่ 4.3 โครงสร้างของตู้ควบคุมความชื้นที่ทำการประกอบ

ในส่วนของฝาตู้ก็ใช้พลาสติกแข็งชนิดเดียวกัน แล้วทำการตัดให้ได้ขนาดพอดีกับตัวตู้ เพื่อจะได้ไม่มีอากาศผ่านเข้าไปได้



รูปที่ 4.4 โครงสร้างของฝาปิดตู้ควบคุมความชื้น

เมื่อทำโครงสร้างของผู้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงทำการประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความชื้น ซึ่งประกอบด้วย เพลทเทียร์ แผ่นอลูมิเนียม Heat Sink และพัดลมระบายความร้อน โดยจะใช้น็อตยึดเพื่อให้มีความมั่นคง เมื่อประกอบเสร็จแล้ว จึงทำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความชื้นนี้เข้ากับตู้ควบคุมความชื้นทางด้านหลังที่ทำช่องสำหรับติดตั้งไว้แล้วไว้แล้ว



รูปที่ 4.5 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความชื้นเข้ากับตู้ควบคุมความชื้น



รูปที่ 4.6 ตู้ควบคุมความชื้นเมื่อประกอบเสร็จแล้ว

4.4 การทดลอง

4.4.1 นำตู้ควบคุมความชื้นที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อเข้ากับสวิทซ์เพาเวอร์ซัพพลาย

4.4.2 เปิดสวิทซ์ที่สวิทซ์เพาเวอร์ซัพพลายเพื่อจ่ายไฟเข้าเลี้ยงวงจรภายในตู้ควบคุมความชื้น

4.4.3 หลังจากที่ย้ายไฟเลี้ยงให้กับตู้ควบคุมความชื้นแล้ว ไฟแสดงผลของวงจรควบคุมความชื้นแบบดิจิตอล จะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นปกติกภายในตู้ควบคุมความชื้น

4.4.4 จากนั้นทำการตั้งค่าความชื้นโดย

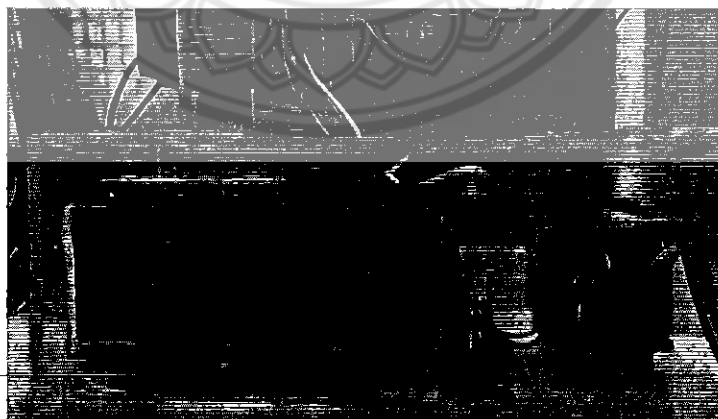
- กดปุ่ม SET ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที จะเป็นการเซตค่าความชื้นต่ำ
- กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งค่าความชื้นต่ำตามที่ต้องการ
- กดปุ่ม SET อีก 1 ครั้ง ที่ LCD จะแสดงค่าความชื้นสูงที่ต้องการเซต
- กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งค่าความชื้นสูงตามที่ต้องการ
- กดปุ่ม SET อีก 1 ครั้ง จะกลับไปแสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นตามปกติ

4.4.5 ทำการทดลอง 3 ช่วง ณ อุณหภูมิเริ่มต้น 29 °C และความชื้นเริ่มต้น 67%

- การทดลองช่วงที่ 1 ความชื้น 50-60%
- การทดลองช่วงที่ 2 ความชื้น 40-50%
- การทดลองช่วงที่ 3 ความชื้น 30-40%

4.4.6 ทำการบันทึกผลการทดลองทุกๆ 5 นาที

4.5 ผลการทดลอง

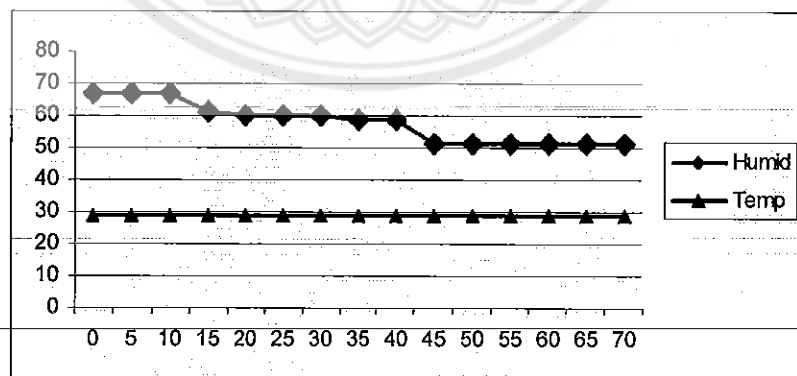


รูปที่ 4.7 การทำงานของผู้ควบคุมความชื้น

4.5.1 การทดลองช่วงที่ 1 เมื่อตั้งค่าความชื้นต่ำที่ 50% และค่าความชื้นสูงที่ 60%

ตาราง 4.1 ผลการทดลองเมื่อตั้งค่าความชื้น 50-60%

เวลา (นาที)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (°C)
0	67	29
5	67	29
10	67	29
15	61	29
20	60	29
25	60	29
30	60	29
35	59	29
40	59	29
45	51	29
50	51	29
55	51	29
60	51	29
65	51	29
70	51	29

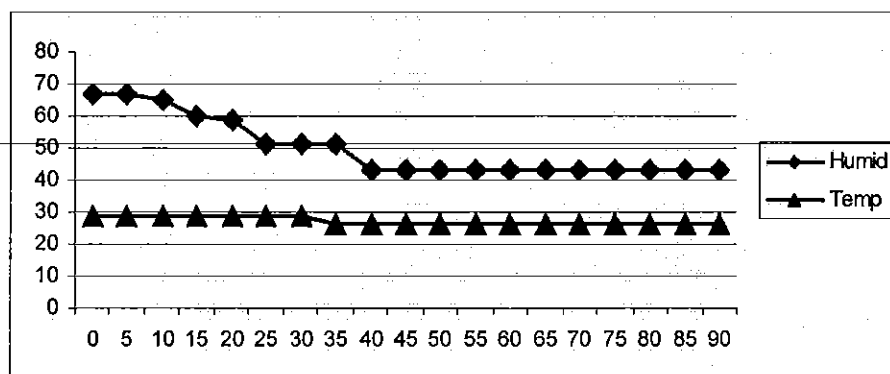


รูปที่ 4.8 กราฟผลการทดลองช่วงที่ 1

4.5.2 การทดลองช่วงที่ 2 เมื่อตั้งค่าความชื้นต่ำที่ 40% และค่าความชื้นสูงที่ 50%

ตาราง 4.2 ผลการทดลองเมื่อตั้งค่าความชื้น 40-50%

เวลา (นาที)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (°C)
0	67	29
5	67	29
10	61	29
15	60	29
20	59	29
25	51	29
30	51	29
35	51	26
40	43	26
45	43	26
50	43	26
55	43	26
60	43	26
65	43	26
70	43	26
75	43	26
80	43	26
85	43	26
90	43	26

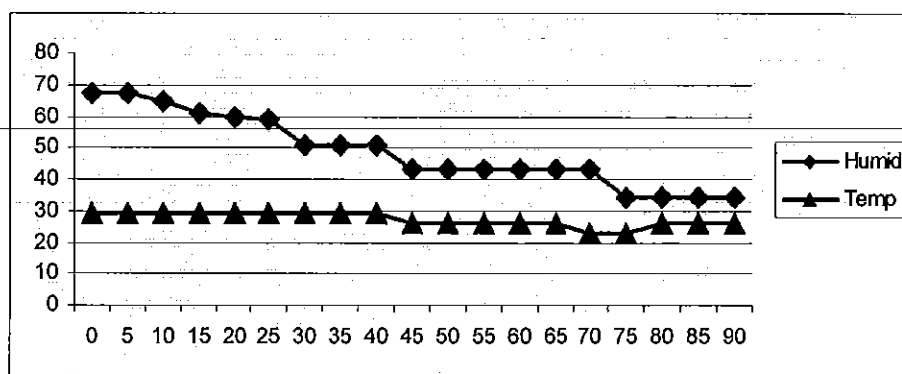


รูปที่ 4.9 กราฟผลการทดลองช่วงที่ 2

4.5.3 การทดลองช่วงที่ 3 เมื่อตั้งค่าความชื้นต่ำที่ 30% และค่าความชื้นสูงที่ 40%

ตาราง 4.3 ผลการทดลองเมื่อตั้งค่าความชื้น 30-40%

เวลา (นาที)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (°C)
0	67	29
5	67	29
10	65	29
15	61	29
20	60	29
25	59	29
30	51	29
35	51	29
40	51	29
45	43	26
50	43	26
55	43	26
60	43	26
65	43	26
70	43	23
75	34	23
80	34	26
85	34	26
90	34	26



รูปที่ 4.10 กราฟผลการทดลองช่วงที่ 3

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาคุณสมบัติของเพลเทียร์ ทำให้ทราบหลักการการทำงานของเพลเทียร์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ทำเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานด้านความเย็นและความร้อนได้หลายอย่าง โดยโครงการนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการใช้เพลเทียร์ในการควบคุมความชื้นภายในตู้ควบคุมความชื้น

ซึ่งโครงการนี้สามารถควบคุมความชื้นได้ต่ำสุดที่ 34%RH ณ อุณหภูมิ 23-26 °C ซึ่งค่าความชื้นระดับนี้ สามารถเก็บรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆได้มากมาย อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตู้ที่มีขนาดใหญ่ได้

ในส่วนของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ป้อนกระแสให้กับ เพลเทียร์, วงจรควบคุมและส่วนอื่นๆนั้น ในช่วงแรกได้ใช้หม้อแปลงของวงจรเรียงกระแส ทำให้เกิดปัญหาคือ กระแสจากหม้อแปลงไม่พอสำหรับเพลเทียร์ ทำให้เพลเทียร์ไม่ทำงาน เพราะฉะนั้นจึงได้เลือกใช้ สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย ของคอมพิวเตอรื ขนาด 450 วัตต์ ซึ่งสามารถจ่ายกระแสได้สูงเหมาะสมกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้หม้อแปลงของวงจรเรียงกระแส

อุปสรรคในการทดลองคือ ขณะที่เพลเทียร์ ทำหน้าที่สร้างความเย็นนั้นจะส่งผลกระทบต่อด้านความร้อนมาก กล่าวคือ ถ้าเราไม่สามารถระบายความร้อนทางด้านเพลตร้อนของเพลเทียร์ ได้ทันจะทำให้ตัวเพลเทียร์ทำความเย็นได้น้อยลงเช่นกัน ทำให้ความชื้นภายในตัวถังของตู้ไม่ลดลงตามที่คาดการณ์เอาไว้ นอกจากนั้นแล้ว สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้ก็ยังไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามที่เราต้องการทำให้วงจรทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลงด้วย และในระหว่างการทำการทดลองนั้นก็เกิดความเสียหายขึ้นกับเพลเทียร์ตัวหนึ่งด้วย ทำให้ผลการทดลองในช่วงแรกเกิดความคลาดเคลื่อนพอสมควร จึงจำเป็นต้องหาเพลเทียร์ตัวใหม่มาทดแทน เพื่อให้การทดลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการทดลองที่แม่นยำ

เอกสารอ้างอิง

- [1] สมโภชน์ อุทัยวิวัฒน์กุล. **หลักการดำเนินงานของอุปกรณ์เพลเทียร์ในการสร้างความเย็น**. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2541
- [2] รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล. **ภาษาแอสเซมบลีสำหรับ MCS-51**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2546
- [3] ขจร อนุดิษฐ์. **การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C**. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2550
- [4] เจริญพร เลิศสถิตชนกร และ วิชาญ ศรีสุวรรณณ์. **“การศึกษาเชิงทดลองของฝ้าเพดานทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริก”**. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 18. 18-20 ตุลาคม 2547.
- [5] เจนศักดิ์ เอกบุรณะวัฒน์ และ สมิต อินทร์ศิริพงษ์. **“ตู้ทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก”**. การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 1. 11-13 พฤษภาคม 2548.
- [6] <http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.datasheet/TEC1-12710.pdf>
- [7] http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/03_humidity_sensor_sht15.htm
- [8] <http://www.thaimicrotron.com/Sensor/SHT1x.htm>
- [9] <http://www.melcor.com/tec.html>
- [10] HuiTong Dry-Cabinet Instruction Manual



ภาคผนวก ก

อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรการควบคุม

1. ตัวต้านทานขนาด $\frac{1}{4}$ วัตต์ $\pm 5\%$

RN1 ตัวต้านทานเน็ตเวิร์ก 9 ขา 10k Ω	1 ตัว
R2, R3, R4, R5 10k Ω	4 ตัว
R6 1k Ω	1 ตัว
R7, R9 4.7k Ω	2 ตัว
R8, R10 390 Ω	2 ตัว

2. ตัวเก็บประจุ

C1 - 1 μ F 16V อิเล็กโทรไลต์	1 ตัว
C2 - 10 μ F 16V อิเล็กโทรไลต์	1 ตัว
C3 - 1000 μ F 16V อิเล็กโทรไลต์	1 ตัว
C4, C5 - 22pF เซรามิก	2 ตัว

3. อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

IC1 - ไอซีเบอร์ AT89C2051 (ที่โปรแกรมแล้ว)	1 ตัว
IC2 - ไอซีเบอร์ 7805	1 ตัว
IC3 - ไอซีเบอร์ 24LC02 (แบบเซอร์เฟสเมต)	1 ตัว
IC4 - SHT15	1 ตัว
Q1, Q2 - ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC547	2 ตัว
D1, D2, D3, D4 - ไดโอดเบอร์ 1N4148	4 ตัว
D5, D6 - ไดโอดเบอร์ 1N4001	1 ตัว
LED1 - สีแดง ขนาด 3 มม.	1 ตัว
LED2 - สีเขียว ขนาด 3 มม.	1 ตัว
LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 1 บรรทัด	1 ตัว

4. อุปกรณ์อื่นๆ

S1, S2, S3 - สวิตช์กดปิดปล่อยดับขนาดเล็ก	3 ตัว
XTAL1 - Crystal 12 MHz.	1 ตัว

RY1 – Relay 12 V 1 contact	2 ตัว
T1 – หม้อแปลง 12 VDC	1 ตัว
ซี็อกเก็ตไอซี 20 ขา	1 ตัว
ซี็อกเก็ตไอซี 8 ขา	1 ตัว
เทอร์มินอลบล็อก 3 ขา	2 ตัว
คอนเน็กเตอร์ตัวผู้ 10 ขา	1 ตัว
คอนเน็กเตอร์ตัวเมีย 10 ขา	1 ตัว
คอนเน็กเตอร์ตัวผู้ 5 ขา	1 ตัว
คอนเน็กเตอร์ตัวเมีย 5 ขา	1 ตัว
คอนเน็กเตอร์ตัวผู้ 2 ขา	1 ตัว
คอนเน็กเตอร์ตัวเมีย 2 ขา	1 ตัว



ภาคผนวก ข

เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น SHT-15



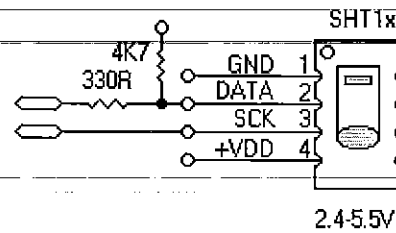
รูปที่ ก.1 เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น SHT-15

คุณสมบัติ

- อุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้มีความสัมพันธ์กัน
- ให้ค่าเอาต์พุตเป็นดิจิตอล
- มีเสถียรภาพดีแม้จะใช้งานนาน
- ไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก
- กินพลังงานไฟฟ้าต่ำ
- มีขนาดเล็ก กะทัดรัด
- Dew point
- Fully calibrate

SHT-15 เป็น chip เดี่ยว ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งเป็นตัว sensor ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การวัดความชื้นและอุณหภูมิที่แสดงผลในระบบ digital โดยเป็น application ของ CMOS ที่ทำงานร่วมกับตัว micro machining ซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือสูงเมื่อต่อใช้งานเป็นเวลานาน โดยที่ตัว SHT-15 ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า capacitive polymer sensing ซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าที่วัดความชื้นและอุณหภูมิ ซึ่ง device ตัวนี้เป็นตัว converter จาก analog เป็น digital แบบ 14bit และตัววงจรภายในต่อกันในรูปแบบอนุกรม ซึ่งทำให้สามารถวัดคุณภาพของสัญญาณได้ดียิ่งขึ้น มีการตอบสนองด้วยเวลาที่

รวดเร็ว และ ไม่ไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งตัว SHT-15 ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและกินพลังงานไฟฟ้าน้อย



รูปที่ ก.2 - Pin Layout

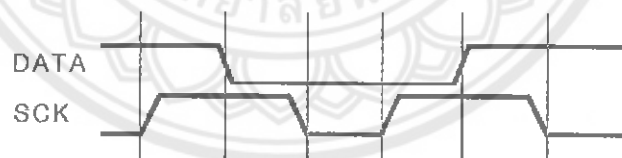
1. Pin Assignment

ตาราง ก.1 Pin Description

Pin	Name	Comment
1	GND	Ground
2	DATA	Serial data, bidirectional
3	SCK	Serial clock, input
4	VDD	Supply 2.4 – 5.5 V
	NC	Remaining pins must be left unconnected

2. ลำดับคำสั่งของ SHT15 (Command Sequence)

2.1 Transmission Start

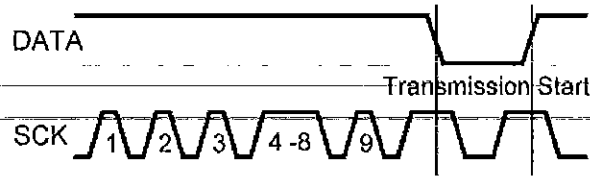


รูปที่ ก.3 Transmission start sequence

ลักษณะเงื่อนไขของสัญญาณมีลักษณะเป็น

- Data เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 \downarrow ขณะที่ SCK ลูกแรก เป็น 1
- Data เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 \uparrow ขณะที่ SCK ลูกที่ 2 เป็น 1

2.2 Connection reset sequence

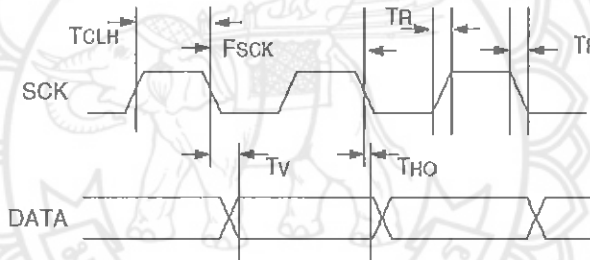


รูปที่ ก.4 Connection reset sequence

- เมื่อขาดการติดต่อกับอุปกรณ์ ให้ส่ง SCK ไปอย่างน้อย 9 ลูก ขณะที่ Data เป็น 1

แล้วตามด้วย Transmission Start

2.3 I/O Characteristics



รูปที่ ก.5 Timing Diagram

ตาราง ก.2

	Parameter	Conditions	Min	Typ.	Max.	Unit
FSCK	SCK frequency	VDD > 4.5 V			10	MHz
		VDD < 4.5 V			1	MHz
TRFO	DATA fall time	Output load 5 pF	3.5	10	20	ns
		Output load 100 pF	30	40	200	ns
TCLH	SCK high time		100			ns
TCLL	SCK low time		100			ns
TV	DATA valid from			50		ns
THO	Output hold time		0	10		ns
TR/TF	SCK rise/fall time				200	ns

3. รายละเอียดของคำสั่ง

ตาราง ก.3 List of Command

Command	Code	Description
Reserved	0000x	Reserved
Measure Temperature	00011	Temperature measurement
Measure Humidity	00101	Humidity measurement
Status Register Read	00111	Read access to the status register (see application note)
Status Register Write	00110	Write access to the status register (see application note)
Reserved	0101x- 1110x	Reserved
Soft-reset	11110	resets the chip, clears the status register to default values wait 11ms before next command

3.1 การอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์

ชุดคำสั่งประกอบด้วย Transmission Start + Address + Command

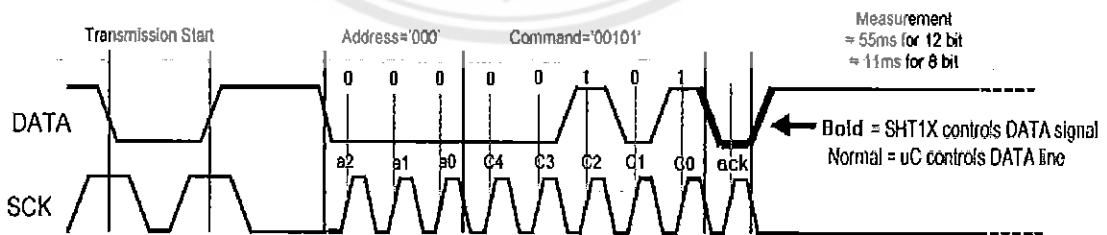
โดย Address = 000 3 + Command 5 bit



รูปที่ ก.6 การรับส่งข้อมูล

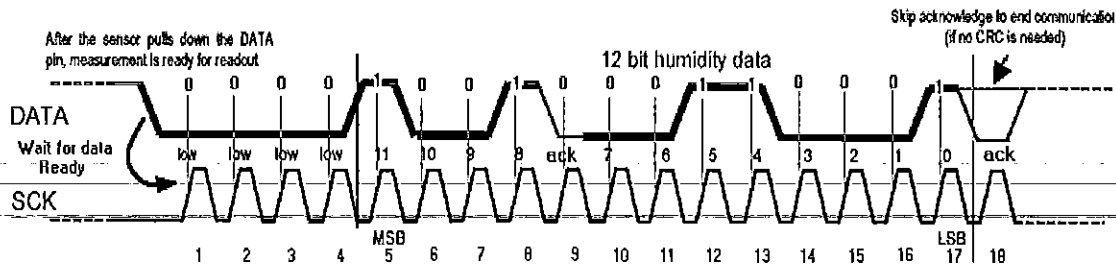
3.2 การอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Measurement sequence T and RH)

ตัวอย่างเมื่อไมโครฯ ต้องการอ่านค่า Humidity จาก sensor ซึ่งมี address = 000 และ คำสั่ง = 00101 จะมีชุดคำสั่งดังนี้



รูปที่ ก.7 ลักษณะสัญญาณในการอ่านข้อมูลจาก Sensor

เมื่อ Sensor รับทราบคำสั่งแล้วจะส่ง acknowledge (ACK) ด้วยการดึงขา Data ลง เป็น 0 (สั้นทึบ)



รูปที่ ก.8 ลักษณะสัญญาณในการอ่านข้อมูล T/H 2 byte จาก Sensor

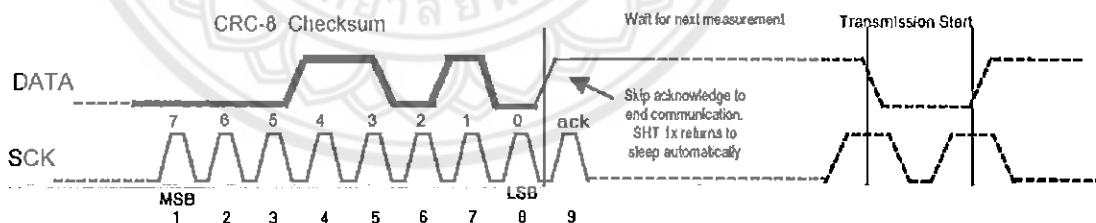
- ข้อมูลของ temperature มีขนาด 14bit และ humidity มีขนาด 12bit (สามารถเปลี่ยนได้เป็น 12 และ 8 bit โดย status register.)

- เมื่อได้รับ acknowledge แล้วให้ไมโครฯ รอสักครู่ประมาณ >210 ms เพื่อให้ Sensor พร้อม แล้วจึงส่งสัญญาณ SCK ต่อไปอีก 2 byte สำหรับรับข้อมูล และ 1 byte สำหรับ ข้อมูลตรวจสอบ ความผิดพลาด (CRC)

จากตัวอย่างจะสามารถอ่านข้อมูล 12 bit ของ Humidity (4 bit แรกเป็น 0 เสมอ) ได้เป็น 0000 1001 0011 0001 = 2353 (dec) = 75.79%RH

เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วหากต้องการ CRC ให้ตอบ acknowledge ด้วยการดึงขา Data ลงเป็น 0 หากไม่ต้องการก็ข้ามขั้นตอนนี้ไป

3.3 การอ่านข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด (CRC)



รูปที่ ก.9 ลักษณะสัญญาณในการอ่านข้อมูล CRC8 1byte จาก Sensor

- ส่งสัญญาณ SCK ต่อไปอีก 1 byte (8 bit) สำหรับ ข้อมูล CRC
- หากสิ้นสุดการติดต่อก็ไม่ต้องตอบ Acknowledge ปล่อยให้ Data เป็น 1 ไว้ เมื่อผ่าน SCK ลูกที่ 9
- หากต้องการอ่านข้อมูลต่อ ให้ตอบ Acknowledge ด้วยการดึงขา Data ลงเป็น 0

ตาราง ก.4 ตารางหาค่า d1, d2 ขนาด 14 bit, 12 bit ที่แรงดัน 5 และ 3V

SOT	Celsius		Fahrenheit	
	d1	d2	d1	d2
14bit 5V	-40	0.01	-40	0.018
12bit 5V	-40	0.04	-40	0.072
14bit 3V	-38.4	0.0098	-37.1	0.0176
12bit 3V	-38.4	0.0392	-37.1	0.0704

3.4 การเปลี่ยนข้อมูล digital

การเปลี่ยนข้อมูล Digital เป็นข้อมูล temperature นั้น ค่าของข้อมูล temperature จะมีลักษณะเป็นเชิงเส้นสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร

$$Temperature = d_1 + d_2 * SO_T \quad (ข.1)$$

เมื่อ SOT = Serial Output Temperature d1, d2 เป็น ค่าคงที่เชิงเส้น เช่นอ่านข้อมูล digital ขนาด 14 bit ได้ SOT = 011010 11111111B = 06911 dec ที่แรงดัน 5 V เมื่อต้องการอ่านค่าเป็นองศา Celsius จะได้ค่า d1 = -40, d2 = 0.01 ผลการคำนวณ temperature = 29.11C

การเปลี่ยนข้อมูล Digital เป็นข้อมูล humidity นั้น ค่าของข้อมูล humidity จะมีลักษณะเป็นเชิงเส้นสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร

$$RH_{linear} = c_1 + c_2 \cdot SO_{RH} + c_3 \cdot SO_{RH}^2 \quad (ข.2)$$

เมื่อ RH = Serial Output humidity แบบ Linear และ c_1, c_2, c_3 มีค่าเป็น

$$c_1 = -4 \quad c_2 = 0.0405 \quad c_3 = -2.8 \cdot 10^{-6} \quad \text{For 12bit } SO_{RH} \quad (ข.3)$$

$$c_1 = -4 \quad c_2 = 0.648 \quad c_3 = -7.2 \cdot 10^{-4} \quad \text{For 8bit } SO_{RH} \quad (ข.4)$$

เมื่อได้ ค่า RH-linear และ Temperature แล้ว หาค่า RH true โดยใช้สูตร

$$RH_{true} = (T_c - 25) \cdot (t_1 + t_2 \cdot SO_{RH}) + RH_{linear} \quad (ข.5)$$

$$t_1 = 0.01; t_2 = 0.00008, \quad t_2 = 0.00128 \quad \text{For 8bit } SO_{RH} \quad (ข.6)$$

เช่นอ่านข้อมูล Digital ขนาด 12 bit ได้ RH-linear = 0110 11111111B = 1791 dec
ที่แรงดัน 5 V อ่านค่า $T_c = 29.11\text{C}$ (จากค่า Temperature) เมื่อต้องการหาค่า
humidity จะได้ค่า $c_1 = -4$, $c_2 = 0.0405$, $c_3 = -0.0000028$
ผลการคำนวณค่า Humidity = 60.18%



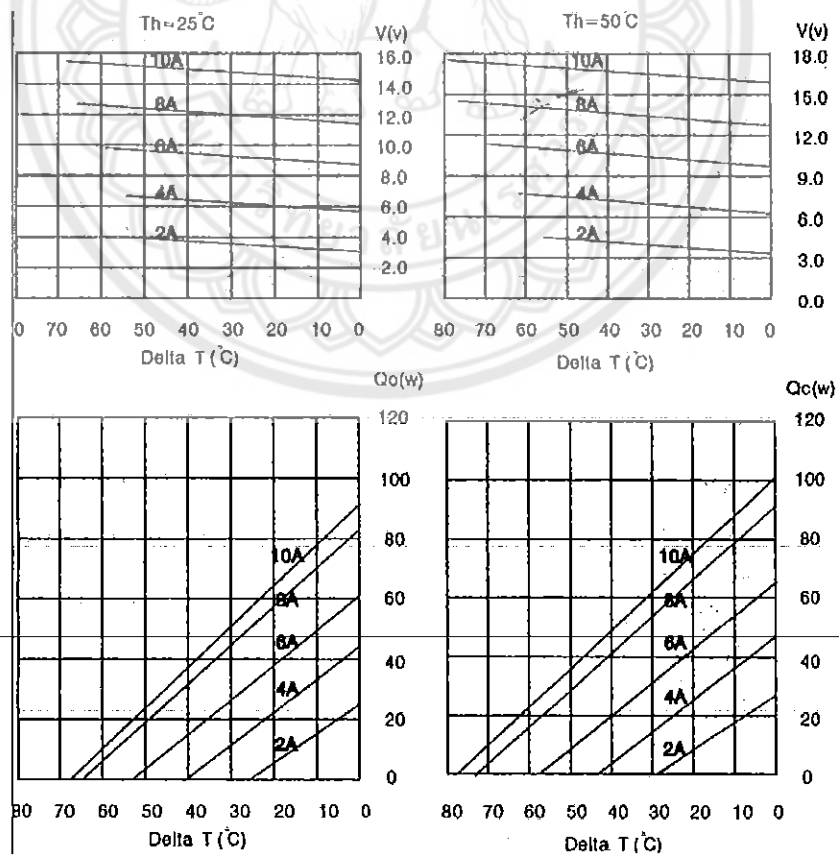
ภาคผนวก ก เพลเทียร์ (Peltier)

ประสิทธิภาพของเพลเทียร์

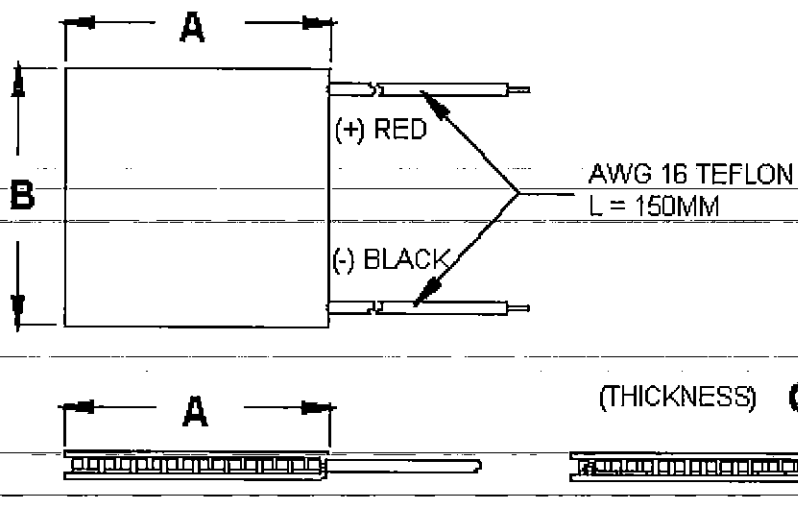
ตาราง ก.1 ประสิทธิภาพของเพลเทียร์

Hot Side Temperature (°C)	25°C	50°C
Qmax (Watts)	85	96
Delta Tmax (°C)	66	75
I _{max} (Amps)	10.5	10.5
V _{max} (Volts)	15.2	17.4
Module Resistance (Ohms)	1.05	1.24

Performance curves



รูปที่ ก.1 กราฟประสิทธิภาพของเพลเทียร์



รูปที่ ก.2 โครงสร้างของเฟลเทียร์

ตาราง ก.2 ขนาดของเฟลเทียร์

A	B	C
40	40	3.3

Ceramic Material: Alumina (Al₂O₃)

Solder Construction: 138°C, Bismuth Tin (BiSn)

Operating Tips

- Max. Operating Temperature: 138°C
- Do not exceed I_{max} or V_{max} when operating module.
- Please consult HB for moisture protection options (sealing).
- Life expectancy: 200,000 hours
- Failure rate based on long time testings: 0.2%.

ภาคผนวก ง

ไฟล์โปรแกรม

```
CPU"8051.TBL"
```

```
HOF"INT8"
```

```
INCL"HEAD51.H"
```

```
;
```

```
; Pin define
```

```
;
```

```
sda: equ p3.0
```

```
sck: equ p1.0
```

```
sw_set: equ p3.5
```

```
sw_up: equ p3.4
```

```
sw_down: equ p3.2
```

```
PORT_LCD: EQU P1 ;Port data to LCD
```

```
RS_LCD: EQU P1.1 ;RS select
```

```
E_LCD: EQU P1.3 ;Enable LCD
```

```
RW_LCD: EQU P1.2 ;R/W select
```

```
RELAY: EQU P3.7 ;Relay
```

```
;
```

```
;Bit define
```

```
;
```

```
a_bit: equ 00
```

```
temp_sign: equ a_bit
```

```
meas_sel: equ a_bit+1
```

```
I2C_ACKNOW: EQU a_bit+2
```

```
-----  
;Internal RAM define  
-----
```

```
a_ram: equ 30h
```

```
lead0: EQU a_ram
```

```
lead1: EQU a_ram+1
```

```
lead2: equ a_ram+2
```

```
lead3: equ a_ram+3
```

```
multi0: EQU a_ram+4
```

```
multi1: EQU a_ram+5
```

```
result0: EQU a_ram+6
```

```
result1: EQU a_ram+7
```

```
result2: EQU a_ram+8
```

```
result3: EQU a_ram+9
```

```
xlead0: EQU a_ram+10
```

```
xlead1: EQU a_ram+11
```

```
xlead2: EQU a_ram+12
```

```
xlead3: EQU a_ram+13
```

```
xlead4: EQU a_ram+14
```

```
xlead5: EQU a_ram+15
```

```
xmulti0: EQU a_ram+16
```

```
xmulti1: EQU a_ram+17
```

```
xresult0: EQU a_ram+18
```

```
xresult1: EQU a_ram+19
```

```
xresult2: EQU a_ram+20
```

```
xresult3: EQU a_ram+21
```

```
xresult4: EQU a_ram+22
```

```
xresult5: EQU a_ram+23
```

```
rhlin_0: equ a_ram+24
```

```
rhlin_1: equ a_ram+25
```

rhlin1_0: equ a_ram+26
rhlin1_1: equ a_ram+27
rhlin2_0: equ a_ram+28
rhlin2_1: equ a_ram+29

rhtrue0: equ a_ram+30
rhtrue1: equ a_ram+31
rhtrue1_0: equ a_ram+32

~~rhtrue1_1: equ a_ram+33~~

rhtrue2_0: equ a_ram+34
rhtrue2_1: equ a_ram+35
rhtrue3_0: equ a_ram+36
rhtrue3_1: equ a_ram+37
rhtrue4_0: equ a_ram+38
rhtrue4_1: equ a_ram+39

sorh0: equ a_ram+40
sorh1: equ a_ram+41

temp_0: equ a_ram+42
temp_1: equ a_ram+43
temp1_0: equ a_ram+44
temp1_1: equ a_ram+45

sot0: equ a_ram+46
sot1: equ a_ram+47

bcd0: equ a_ram+48
bcd1: equ a_ram+49
hex_m: equ a_ram+50

dspbuf0: equ a_ram+51

```
dspbuf1:    equ    a_ram+52
```

```
dspbuf2:    equ    a_ram+53
```

```
tempshow0:  equ    a_ram+54
```

```
tempshow1:  equ    a_ram+55
```

```
tempshow2:  equ    a_ram+56
```

```
rhshow0:    equ    a_ram+57
```

```
rhshow1:    equ    a_ram+58
```

```
rhshow2:    equ    a_ram+59
```

```
rhmin0:     equ    a_ram+60
```

```
rhmin1:     equ    a_ram+61
```

```
rhmax0:     equ    a_ram+62
```

```
rhmax1:     equ    a_ram+63
```

```
rh_minset:  equ    a_ram+64
```

```
rh_maxset:  equ    a_ram+65
```

```
I2C_ADDR:   EQU    a_ram+66
```

```
I2C_DATA:   EQU    a_ram+67
```

```
TEMP_RAM:   EQU    a_ram+68
```

```
DATA_BUF:   EQU    a_ram+69
```

```
EEP_ADR_D:  EQU    a_ram+70
```

```
;-----
```

```
;Constant define
```

```
;-----
```

```
meas_temp:  equ    00000011b ;measure temp code = 03h
```

```
meas_humi:  equ    00000101b ;measure humi code = 05h
```

```
EEP_ADR_W:  EQU    0A0H ;1010xxx0B is code eeprom_wr
```

```
EEP_ADR_R:  EQU    0A1H ;1010xxx1B is code eeprom_rd
```

```
EEP_AD_min: EQU 10h
```

```
eep_ad_max: equ 20h
```

```
*****
```

```
ORG 0000h
```

```
MAIN:   clr    relay
        mov    b,#128
```

```
        mov    r0,#a_ram
```

```
clr_ram: mov    @r0,#00
```

```
        inc    r0
```

```
        djnz   b,clr_ram
```

```
        ;-----
        ;อ่านข้อมูลจาก eeprom
        ;-----
```

```
        mov    a,#EEP_AD_min
```

```
        lcall  rd_eeprom
```

```
        mov    rh_minset,data_buf
```

```
        mov    a,#eep_ad_max
```

```
        lcall  rd_eeprom
```

```
        mov    rh_maxset,data_buf
```

```
        ;-----
```

```
CLR    RW_LCD
```

```
CLR    E_LCD    ;Disable LCD
```

```
MOV    R2,#0ffH ;Power-on delay
```

```
PWR_DLY: MOV    R3,#0FFH
```

```
        DJNZ  R3,$
```

```
        DJNZ  R2,PWR_DLY
```

```
LCALL  DELAY
```

```

        LCALL INIT_LCD    ;Initial LCD 4 bit 16X1
        ;1st message
LOOP_LCD: MOV  A,#4      ;1st location of line 1
        LCALL GOTO_LCD
        LCALL PRINT_LCD
        DFB  "Humi"      ;Message on line-1
        DFB  00H
        MOV  A,#40H     ;2st location of line 2
        LCALL GOTO_LCD
        LCALL PRINT_LCD
        DFB  "dity"      ;Message on line-2
        DFB  00H
        mov  r7,#250
        lcall delay_10ms
        mov  r7,#250
        lcall delay_10ms
loop_meas: lcall sht15_con_rst
        lcall sht15_meas    ;อ่านค่าการวัดจาก SHT15
        lcall temp_convrt  ;เปลี่ยน temp ผลอยู่ใน temp_1,temp_0
        lcall rh_convrt    ;เปลี่ยน rh ผลอยู่ใน rhtrue1,rhtrue0
        clr  c
        mov  a,rh_maxset
        subb a,rhtrue1
        jc  onrelay
        clr  c
        mov  a,rh_minset
        subb a,rhtrue1
        jnc onrelay
        clr  relay
        sjmp wwww
onrelay: setb relay

```

```

www:      mov    hex_m,temp_1 ;เปลี่ยน temp สำหรับส่ง LCD
          lcall  bin2bcd
          lcall  bcd2asc
          mov    tempshow0,dspbuf0
          mov    tempshow1,dspbuf1
          mov    tempshow2,dspbuf2

          mov    hex_m,rhtrue1 ;เปลี่ยน rh สำหรับส่ง LCD
          lcall  bin2bcd
          lcall  bcd2asc
          mov    rhshow0,dspbuf0
          mov    rhshow1,dspbuf1
          mov    rhshow2,dspbuf2
          lcall  norshow
          clr    c
          JNB   SW_set,swset_chk
          sjmp  cccc

swset_chk: mov    r7,#1
          ICALL delay_10ms
          JB    SW_set,cccc
          lcall  set_rh

cccc:     ljmp  loop_meas
          sjmp  $

```

```

;+++++

```

```

;////////

```

```

;-----

```



```
; Program read data from EEPROM
```

```
; I/P :
```

```
; O/P :
```

```
; Reg :R0,R2
```

```
;-----
```

```
RD_EEPROM: MOV I2C_ADDR,#EEP_ADR_W
```

```
ACALL I2C_TX_ADDR ; Connect to slave
```

```
MOV I2C_DATA,a ; EEPROM ADD. Pointer
```

```
ACALL I2C_TX_DATA
```

```
MOV I2C_ADDR,#EEP_ADR_R
```

```
ACALL I2C_TX_ADDR ; Connect to slave
```

```
MOV R0,#DATA_BUF ;ข้อมูลอยู่ใน data_buf
```

```
ACALL I2C_RX_DATA
```

```
SETB SDA
```

```
ACALL I2C_DELAY
```

```
ACALL I2C_CLK
```

```
ACALL I2C_STOP
```

```
RET
```

```
;-----
```

```
; I2C Slave Data Read
```

```
; I/P :
```

```
; O/P :
```

```
; Reg :A,R3
```

```
;-----
```

```
I2C_RX_DATA: PUSH A
```

```
CLR A
```

```
MOV R3,#08H
```

```
I2C_DATA_RD_1: ACALL I2C_DELAY
```

```
SETB SCK
```

```
ACALL I2C_DELAY
```

```
MOV C, SDA
```

```
RLC A
```

```
CLR SCK
```

```
DJNZ R3, I2C_DATA_RD_1
```

```
MOV @R0, A
```

```
POP A
```

```
RET
```

```
;-----
```

```
; Program write data to EEPROM
```

```
; I/P :
```

```
; O/P :
```

```
; Reg :R0,R2
```

```
;-----
```

```
WR_EEPROM: MOV I2C_ADDR, #EEP_ADR_W
```

```
ACALL I2C_TX_ADDR ; Connect to slave
```

```
MOV I2C_DATA, A ; EEPROM ADD. Pointer
```

```
ACALL I2C_TX_DATA
```

```
MOV R0, #DATA_BUF
```

```
MOV I2C_DATA, @R0
```

```
ACALL I2C_TX_DATA
```

```
ACALL I2C_STOP
```

```
RET
```

```

;-----
; I2C Slave Address Connect
; I/P :
; O/P :
; Reg :A,R3
;-----
I2C_TX_ADDR:      PUSH  A
                  SETB  I2C_ACKNOW
                  MOV   A,I2C_ADDR
                  ACALL I2C_START
                  MOV   R3,#08H
I2C_SLAVE_1:      RLC   A
                  MOV   SDA,C
                  ACALL I2C_CLK
                  DJNZ  R3,I2C_SLAVE_1
                  SETB  SDA      ;Acknowledge bit
                  ACALL I2C_DELAY
                  SETB  SCK
                  ACALL I2C_DELAY
                  JB    SDA,I2C_SLAVE_2
                  CLR   I2C_ACKNOW
I2C_SLAVE_2:      CLR   SCK
                  POP   A
                  RET

```

```

;-----
; I2C Slave Data Write

```

```

; I/P :

```

```

; O/P :

```

```

; Reg :A,R3

```

```

;-----

```

```
I2C_TX_DATA:    PUSH  A
                SETB  I2C_ACKNOW
                MOV   A,I2C_DATA
                MOV   R3,#08H
                I2C_DATA_WR_1: RLC  A
                MOV   SDA,C
                ACALL I2C_CLK
                DJNZ  R3,I2C_DATA_WR_1
                SETB  SDA
                ACALL I2C_DELAY
                SETB  SCK
                ACALL I2C_DELAY
                JB   SDA,I2C_DATA_WR_2
                CLR  I2C_ACKNOW
I2C_DATA_WR_2: CLR  SCK
                POP  A
                RET
;-----
; I2C Start Condition
; I/P :
; O/P :
; Reg :
;-----
I2C_START:    SETB  SCK
                SETB  SDA
                ACALL I2C_DELAY
                CLR  SDA
                ACALL I2C_DELAY
                CLR  SCK
                RET
```

```
-----
```

```
; I2C Stop Condition
```

```
; I/P :
```

```
; O/P :
```

```
; Reg :
```

```
-----
```

```
I2C_STOP: CLR SDA
```

```
ACALL I2C_DELAY
```

```
SETB SCK
```

```
ACALL I2C_DELAY
```

```
SETB SDA
```

```
RET
```

```
-----
```

```
; I2C Clock
```

```
; I/P :
```

```
; O/P :
```

```
; Reg :
```

```
-----
```

```
I2C_CLK: ACALL I2C_DELAY
```

```
SETB SCK
```

```
ACALL I2C_DELAY
```

```
CLR SCK
```

```
RET
```

```
-----
```

```
; I2C Delay
```

```
; I/P :
```

```
; O/P :
```

```
; Reg : R6
```

```
-----
```

```
I2C_DELAY: MOV R6,#0CH
```

```

I2C_DELAY_1: NOP
                NOP
                DJNZ R6,I2C_DELAY_1
                RET

```

```

;////////////////////////////////////

```

```

;-----

```

```

; set_rh_min

```

```

;-----

```

```

set_rh: clr     relay
                lcall  showsetmin

                jnb   sw_set,$ ;////////////////////////////////////

set_rhmin1:  jnb   sw_up,rhmin_up
                jnb   sw_down,rhmin_down
                JNB   SW_set,set_rhmax
                sjmp  set_rhmin1

rhmin_up:   mov   r7,#1
                lcall delay_10ms
                jb   sw_up,set_rhmin1
                MOV   R4,rh_minset
                CJNE R4,#99,INC_rhmin
                sJMP  NOmin_UP

INC_rhmin:  INC   rh_minset

```

```

NOmin_UP:  lCALL  showsetmin

```

```

                SJMP  set_rhmin1

```

```

rhmin_down:  mov  r7,#1
              lcall delay_10ms
              jb   sw_down,set_rhmin1
              MOV  R4,rh_minset
              CJNE R4,#00,dec_rhmin
              sJMP NOmin_down
dec_rhmin:   dec  rh_minset

```

```

NOmin_down: lCALL showsetmin

```

```

sJMP set_rhmin1

```

```

set_rhmax:   mov  r7,#1
              lcall delay_10ms
              jb   sw_set,set_rhmin1
              lcall showsetmax
              jnb  sw_set,$
set_rhmax1:  jnb  sw_up,rhmax_up
              jnb  sw_down,rhmax_down
              JNB  SW_set,saveset
              sjmp set_rhmax1

```

```

rhmax_up:   mov  r7,#1
              lcall delay_10ms
              jb   sw_up,set_rhmax1
              MOV  R4,rh_maxset
              CJNE R4,#99,INC_rhmax
              sJMP NOmax_UP
INC_rhmax:  INC  rh_maxset

```

```

)
    NOmax_UP:  ICALL showsetmax

```

```

    SJMP set_rhmax1

```

```

rhmax_down:  mov   r7,#1

```

```

                lcall delay_10ms

```

```

                jb    sw_down,set_rhmax1

```

```

                MOV   R4,rh_maxset

```

```

                CJNE  R4,#00,dec_rhmax

```

```

                SJMP  NOmax_down

```

```

dec_rhmax:    dec   rh_maxset

```

```

NOmax_down:  ICALL showsetmax

```

```

                SJMP  set_rhmax1

```

```

saveaset:   mov   r7,#1

```

```

                lcall delay_10ms

```

```

                jb    sw_set,set_rhmax1

```

```

                mov   r7,#200

```

```

saveDELAY:  MOV   TMOD,#01H ;T0 to timer model DELAY_10mS

```

```

                MOV   TH0,#0DCH

```

```

                MOV   TL0,#0BFH

```

```

                SETB  TR0

```

```

jjjj:       jb    sw_set,set_rhmax1

```

```

                JNB   TF0,jjjj

```

```

                CLR   TR0

```

```

                CLR   TF0

```

```

                DJNZ  R7,saveDELAY

```



```

mov    a,#EEP_AD_min
mov    data_buf,rh_minset
lcall  wr_eeprom

```

```

mov    r7,#20
lcall  delay_10ms

```

```

mov    a,#eep_ad_max
mov    data_buf,rh_maxset
lcall  wr_eeprom

```

```

lcall  norshow

```

```

jnb    sw_set,$

```

```

RET

```

```

;*****
;

```

```

; Normal show temp. $ %RH

```

```

;*****
;

```

```

norshow:    MOV    A,#01H        ;Clear display

```

```

            LCALL  WR_INS        ;Clear display,Set DD RAM addr=0

```

```

            MOV    A,#0          ;1st location of line 1

```

```

            LCALL          GOTO_LCD

```

```

            LCALL          PRINT_LCD

```

```

            DFB    " T="        ;Message on line-1

```

```

;DFB    0dfh

```

```

            DFB    00H

```

```

            MOV    A,#40H.      ;2st location of line 2

```

```

LCALL    GOTO_LCD
LCALL    PRINT_LCD
DFB     " RH="          ;Message on line-2
DFB     00H

MOV     A,#03h          ;แสดง temp on lcd
LCALL    GOTO_LCD
mov     a,tempshow2
cjne    a,#30h,nextshow
sjmp    nextshow1
nextshow: lcall wr_lcd
nextshow1: mov a,tempshow1
cjne    a,#30h,nextshow2
sjmp    nextshow3
nextshow2: lcall wr_lcd
nextshow3: mov a,tempshow0
lcall   wr_lcd
mov     a,#0dfh
lcall   wr_lcd

MOV     A,#44h          ;แสดง temp on lcd
LCALL    GOTO_LCD
;mov    a,rhshow2
;lcall  wr_lcd
mov     a,rhshow1
cjne    a,#30h,nextshow4
sjmp    nextshow5

nextshow4: lcall wr_lcd
nextshow5: mov a,rhshow0
lcall   wr_lcd
mov     a,#25h
lcall   wr_lcd

```

```

mov    r7,#250
lcall  delay_10ms

mov    r7,#250
lcall  delay_10ms

ret

```

```

;*****
; Show set min
;*****

showsetmin:  mov    hex_m,rh_minset ;เปลี่ยน temp สำหรับส่ง LCD
              lcall  bin2bcd
              lcall  bcd2asc
              mov    rhmin0,dspbuf0
              mov    rhmin1,dspbuf1

              MOV    A,#01H      ;Clear display
              LCALL  WR_INS      ;Clear display,Set DD RAM addr=0

              MOV    A,#0        ;1st location of line 1
              LCALL  GOTO_LCD
              LCALL  PRINT_LCD
              DFB    "Set: Low"   ;Message on line-1
              DFB    00H

              MOV    A,#40H      ;2st location of line 2
              LCALL  GOTO_LCD
              LCALL  PRINT_LCD
              DFB    " RH="      ;Message on line-2

```

DFB 00H

```

MOV A,#44h ;ติดตั้ง set min.rh-on.lcd
LCALL GOTO_LCD
;mov a,rhshow2
;call wr_lcd
mov a,rhmin1
cjrc a,#30h,dddshow4
sjmp dddshow5
dddshow4: lcall wr_lcd
dddshow5: mov a,rhmin0
lcall wr_lcd
mov a,#25h
lcall wr_lcd
mov r7,#50
lcall delay_10ms
ret

;*****
; Show set max
;*****

showsetmax: mov hex_m,rh_maxset ;เปลี่ยน temp สำหรับส่ง LCD
lcall bin2bcd
lcall bcd2asc
mov rhmax0,dspbuf0
mov rhmax1,dspbuf1

MOV A,#01H ;Clear display
LCALL WR_INS ;Clear display,Set DD RAM addr=0

```

```

MOV A,#0          ;1st location of line 1
LCALL GOTO_LCD
LCALL PRINT_LCD
DFB "Set:High"    ;Message on line-1
DFB 00H
MOV A,#40H        ;2st location of line 2
LCALL GOTO_LCD
LCALL PRINT_LCD
DFB "RH="         ;Message on line-2
DFB 00H

MOV A,#44h        ;แสดง set min rh on lcd
LCALL GOTO_LCD
;mov a,rhshow2
;lcall wr_lcd
mov a,rhmax1
cjne a,#30h,eeeshow4
sjmp eeeshow5
eeeshow4: lcall wr_lcd
eeeshow5: mov a,rhmax0
lcall wr_lcd
mov a,#25h
lcall wr_lcd

mov r7,#50
lcall delay_10ms

ret

;*****
; การอ่านข้อมูลจาก SHT15
;*****
sht15_meas:  clr    meas_sel          ;อ่าน temp

```

```
lcall sht15_rd_meas
```

```
mov r7,#30
```

```
lcall delay_10ms
```

```
lcall sht15_con_rst
```

```
setb meas_sel ;อ่าน humi
```

```
lcall sht15_rd_meas
```

```
ret
```

```
*****
```

```
; SHT15 connection reset
```

```
*****
```

```
sht15_con_rst: setb sda
```

```
clr sck
```

```
mov b,#09h
```

```
con_rst_1: setb sck
```

```
lcall sht15_wait
```

```
clr sck
```

```
lcall sht15_wait
```

```
djnz b,con_rst_1
```

```
lcall sht15_trans_st
```

```
ret
```

```
*****
```

```
; SHT15 transmission start
```

```
*****
```

```
sht15_trans_st: setb sda
```

```
clr sck
```

```
lcall sht15_wait
```

```

        setb    sck
        lcall   sht15_wait
        clr     sda
        lcall   sht15_wait
        clr     sck
        lcall   sht15_wait
        setb    sck
        lcall   sht15_wait
        setb    sda
        lcall   sht15_wait
        clr     sck
        ret

;*****
; SHT15 wait
;*****
sht15_wait:  push    b
             mov     b,#08
sht15_wait_1: nop
             djnz   b,sht15_wait_1
             pop    b
             ret

;*****
; SHT15 write command
;*****
sht15_wr_cmd: mov    b,#08h
sht15_wrcmd_1: rlc    a
               mov    sda,c
               nop
               nop
               setb   sck

```

```

        lcall  sht15_wait
        clr   sck
        djnz  b,sht15_wrcmd_1
        setb  sda
        setb  sck
        lcall sht15_wait
        clr   sck
        ret

```

```

;*****
;
; SHT15      read command
;*****
sht15_rd_cmd: ;setb  sda
              mov   b,#08h
sht15_rdcmd_1: setb  sck
              nop
              nop
              mov  c,sda
              rlc  a
              clr  sck
              nop
              nop
              djnz b,sht15_rdcmd_1
              clr  sda
              setb sck
              lcall sht15_wait
              clr  sck
              ret

```

```

;*****
;
; Read measure temp. & humidity from SHT15
;*****

```



```

sht15_rd_meas: lcall  sht15_trans_st
                jnb   meas_sel,rd_meas_rh
                mov   a,#meas_temp
                lcall  sht15_wr_cmd
                mov   r7,#30
                lcall  delay_10ms
                lcall  sht15_rd_cmd
                mov   sot1,a
                lcall  sht15_rd_cmd
                setb  sda
                mov   sot0,a
                sjmp  stop_rd_meas
rd_meas_rh:    mov   a,#meas_humi
                lcall  sht15_wr_cmd
                mov   r7,#15
                lcall  delay_10ms
                lcall  sht15_rd_cmd
                mov   sorh1,a
                lcall  sht15_rd_cmd
                setb  sda
                mov   sorh0,a
stop_rd_meas: ret

;*****
;Delay 10 mS
;I/P : R7
;O/P : None
;Reg. : None
;*****
DELay_10mS: MOV  TMOD,#01H ;T0 to timer mode1
            MOV  TH0,#0DCH
            MOV  TL0,#0BFH

```

```

SETB TR0
WAIT10mS: JNB TF0,WAIT10mS
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,DElay_10mS
RET

```

```

;*****
;convert TEMP. of SHT15 output to Physical values
;*****

```

```

temp_conv:  clr    temp_sign
            mov    lead0,#0f5h    ;d2
            mov    lead1,#28h
            mov    multi0,sot0    ;d2*sot
            mov    multi1,sot1
            lcall  mul16
            mov    temp1_0,result2
            mov    temp1_1,result3

            clr    c
            mov    a,#02h
            subb  a,temp1_1
            jc    temp_con1

            clr    c
            mov    a,temp1_1
            subb  a,#02h
            jc    temp_con2

            clr    c
            mov    a,temp1_0
            subb  a,#80h
            jnc  temp_con1

```

```

temp_con2:  clr    c
            mov    a,#80h
            subb   a,temp1_0
            mov    temp_0,a
            mov    a,#02h
            subb   a,temp1_1
            mov    temp_1,a
            setb   temp_sign
            sjmp   temp_shift_1

temp_con1:  clr    c
            mov    a,temp1_0
            subb   a,#80h
            mov    temp_0,a
            mov    a,temp1_1
            subb   a,#02h
            mov    temp_1,a

temp_shift_1:  mov    b,#4
temp_shift:  clr    c
            mov    a,temp_0
            rlc    a
            mov    temp_0,a
            mov    a,temp_1
            rlc    a
            mov    temp_1,a
            djnz   b,temp_shift

temp_conend:  ret    ;stop temp. convert [temp_1,temp_0 : xx.xx]

```

```

;*****
; convert %RH of SHT15 output to Physical values
;*****

```

```

rh_conv:  mov     lead0,sorh0    ;sorh^2
          mov     lead1,sorh1
          mov     multi0,sorh0
          mov     multi1,sorh1
          lcall   mul16

          mov     xlead0,result0 ;c3*sorh^2
          mov     xlead1,result1
          mov     xlead2,result2
          mov     xlead3,result3

          mov     xmulti0,#0f9h ;c3
          mov     xmulti1,#2eh
          lcall   xmul16
          mov     rhlin1_0,xresult3
          mov     rhlin1_1,xresult4

          mov     lead0,sorh0    ;c2*sorh
          mov     lead1,sorh1
          mov     multi0,#0e3h ;c2
          mov     multi1,#0a5h
          lcall   mul16
          mov     rhlin2_0,result2
          mov     rhlin2_1,result3

          mov     b,#04

rh_shift: clr     c
          mov     a,rhlin2_0
          rlc     a
          mov     rhlin2_0,a
          mov     a,rhlin2_1
          rlc     a
          mov     rhlin2_1,a

```

```
djnz b,rh_shift
```

```
clr c ;c1+c2*sorh
```

```
mov a,rhlin2_1
```

```
subb a,#04h
```

```
mov rhlin_1,a
```

```
mov rhlin_0,rhlin2_0
```

```
clr c ;c1+c2*sorh+c3*sorh^2
```

```
mov a,rhlin_0
```

```
subb a,rhlin1_0
```

```
mov rhlin_0,a
```

```
mov a,rhlin_1
```

```
subb a,rhlin1_1
```

```
mov rhlin_1,a
```

```
===== calculator rhtrue =====
```

```
clr c ;(tc-25)
```

```
mov a,temp_1
```

```
subb a,#19h ;25d
```

```
mov rhtrue1_1,a
```

```
mov rhtrue1_0,#00h
```

```
mov lead0,sorh0 ;t2*sorh
```

```
mov lead1,sorh1
```

```
mov multi0,#0e2h ;t2
```

```
mov multi1,#53h
```

```
lcall mul16
```

```
mov rhtrue2_1,result3
```

```
mov rhtrue2_0,result3
```

```
mov a,rhtrue2_1
```

```
swap a
```

```
anl a,#0fh
```

```
mov rhtrue2_1,a
```

```
mov a,rhtrue2_0
```

```
swap a
```

```
anl a,#0f0h
```

```
mov rhtrue2_0,a
```

```
mov a,rhtrue2_0 ;t1+t2*sorh
```

```
add a,#02H
```

```
mov rhtrue3_0,a
```

```
mov rhtrue3_1,rhtrue2_1
```

```
mov lead0,rhtrue1_0 ;(tc-25)*(t1+t2*sorh)
```

```
mov lead1,rhtrue1_1
```

```
mov multi0,rhtrue3_0
```

```
mov multi1,rhtrue3_1
```

```
lcall mul16
```

```
mov rhtrue4_0,result1
```

```
mov rhtrue4_1,result2
```

```
mov a,rhtrue4_0
```

```
add a,rhlin_0
```

```
mov rhtrue0,a
```

```
mov a,rhtrue4_1
```

```
adde a,rhlin_1
```

```
mov rhtrue1,a
```

```
ret ;stop convert %rh [rhtrue1,rhtrue0 : xx.xx]
```

```

;*****
; 16 bit multiplier
; register : A,B,R0,R1,R7
; i/p : lead1,lead0,multi1,multi0
; o/p : result3,result2,result1,result0
;*****

```

```

mul16:      mov     a,#00
            mov     result0,a
            mov     result1,a
            mov     result2,a
            mov     result3,a

            mov     lead2,#0
            mov     lead3,#0

            mov     b,#16
mul16_re:   clr     c
            mov     a,multi1
            rrc     a
            mov     multi1,a
            mov     a,multi0
            rrc     a
            mov     multi0,a

```

```

            jnc     mul16_1

```

```

            mov     r7,#4
            clr     c
            mov     r0,#lead0
            mov     r1,#result0
mul16_add:  mov     a,@r0
            addc    a,@r1

```

```

        mov    @r1,a
        inc   r0
        inc   r1
        djnz  r7,mul16_add
mul16_1:  mov   r7,#4
        clr   c
        mov   r0,#lead0
mul16_2:  mov   a,@r0
        rlc   a
        mov   @r0,a
        inc   r0
        djnz  r7,mul16_2
        djnz  b,mul16_re
        ret

;*****
; Extra 16 bit multiplier
; register : A,B,R0,R1,R7
; i/p : lead1,lead0,multi1,multi0
; o/p : result3,result2,result1,result0
;*****

xmul16:  mov   a,#00
        mov   xresult0,a
        mov   xresult1,a
        mov   xresult2,a
        mov   xresult3,a
        mov   xresult4,a
        mov   xresult5,a

        mov   xlead4,#00
        mov   xlead5,#00

```



```

mov    b,#16
xmul16_re:  clr    c
           mov    a,xmulti1
           rrc    a
           mov    xmulti1,a
           mov    a,xmulti0
           rrc    a
           mov    xmulti0,a
           jnc    xmul16_1
           mov    r7,#6
           clr    c
           mov    r0,#xlead0
           mov    r1,#xresult0
xmul16_add:  mov    a,@r0
           adde   a,@r1
           mov    @r1,a
           inc    r0
           inc    r1
           djnz   r7,xmul16_add
xmul16_1:  mov    r7,#6
           clr    c
           mov    r0,#xlead0
xmul16_2:  mov    a,@r0
           rlc    a
           mov    @r0,a
           inc    r0
           djnz   r7,xmul16_2
           djnz   b,xmul16_re
           ret

```

```
);
;*****
```

```
; Binary to BCD
```

```
; I/P : hex
```

```
; o/p : bcd2,bcd1,bcd0
```

```
;*****
```

```
bin2bcd:          mov    a,#00
```

```
                mov    bcd0,a
```

```
                mov    bcd1,a
```

```
                mov    a,hex_m
```

```
                rlc    a
```

```
                mov    hex_m,a
```

```
                jnc    chk_bit6
```

```
                mov    bcd1,#01h
```

```
                mov    bcd0,#28h
```

```
chk_bit6:       mov    a,hex_m
```

```
                rlc    a
```

```
                mov    hex_m,a
```

```
                jnc    chk_bit5
```

```
                mov    a,bcd0
```

```
                add    a,#64h
```

```
                daa
```

```
                mov    bcd0,a
```

```
                mov    a,bcd1
```

```
                addc   a,#00h
```

```
                mov    bcd1,a
```

```
chk_bit5:       mov    a,hex_m
```

```
                rlc    a
```

```
                mov    hex_m,a
```

```
                jnc    chk_bit4
```

```
                mov    a,bcd0
```

```
                add    a,#32h
```

```

        daa
        mov  bcd0,a
        mov  a,bcd1
        addc a,#00h
        mov  bcd1,a
chk_bit4:    mov  a,hex_m
            rlc  a
            mov  hex_m,a
            jnc  chk_bit3
            mov  a,bcd0
            add  a,#16h
            daa
            mov  bcd0,a
            mov  a,bcd1
            addc a,#00h
            mov  bcd1,a
chk_bit3:    mov  a,hex_m
            rlc  a
            mov  hex_m,a
            jnc  chk_bit2
            mov  a,bcd0
            add  a,#08h
            daa
            mov  bcd0,a
            mov  a,bcd1
            addc a,#00h
            mov  bcd1,a
chk_bit2:    mov  a,hex_m
            rlc  a
            mov  hex_m,a
            jnc  chk_bit1
            mov  a,bcd0

```

```
        add    a,#04h
        daa
        mov    bcd0,a
        mov    a,bcd1
        -----
        addc   a,#00h
        mov    bcd1,a
        -----
chk_bit1:    mov    a,hex_m
        -----
        rlc    a
        -----
        mov    hex_m,a
        jnc    chk_bit0
        mov    a,bcd0
        add    a,#02h
        daa
        mov    bcd0,a
        mov    a,bcd1
        addc   a,#00h
        mov    bcd1,a
chk_bit0:    mov    a,hex_m
        -----
        rlc    a
        -----
        mov    hex_m,a
        jnc    stop_bin2bcd
        mov    a,bcd0
        add    a,#01h
        -----
        daa
        -----
        mov    bcd0,a
        -----
        mov    a,bcd1
        -----
        addc   a,#00h
        mov    bcd1,a
stop_bin2bcd: ret
```

```

;*****
; BCD to ASCII
;*****

```

```

bcd2asc:      mov    a,bcd0

```

```

                anl    a,#0fh

```

```

                add    a,#30h

```

```

                mov    dspbuf0,a

```

```

                mov    a,bcd0

```

```

                swap   a

```

```

                anl    a,#0fh

```

```

                add    a,#30h

```

```

                mov    dspbuf1,a

```

```

                mov    a,bcd1

```

```

                anl    a,#0fh

```

```

                add    a,#30h

```

```

                mov    dspbuf2,a

```

```

                ret

```

```

;-----
;Initial LCD 4 bit interface
;-----

```

```

INIT_LCD:      MOV    A,#33H      ;DL = 1 , DL = 1

```

```

                LCALL WR_INS

```

```

                MOV    A,#32H      ;DL = 1 , DL = 0

```

```

                LCALL WR_INS

```

```

                MOV    A,#28H      ;Function set

```

```

                LCALL WR_INS      ;DL=0 4bit,N=0 1line,F=0 5x7

```

```

                MOV    A,#0CH      ;Display on/off control

```

```

                LCALL WR_INS      ;Display on,cursor off,not blink

```

```

                MOV    A,#06H      ;Entry mode set

```

```

                LCALL    WR_INS      ;I/D=1

```

Increment,S=0 cursor shift

```

MOV  A,#01H      ;Clear display
LCALL WR_INS     ;Clear display,Set DD RAM addr=0
RET

```

```

;-----
;Write instruction LCD
;Input: Reg. ACC (Command)
;-----

```

```

WR_INS:          PUSH  A      ;Save data low byte
                ANL   A,#0F0H
                MOV  PORT_LCD,A ;High byte & RS=0 Write
                LCALL EN_LCD
                POP  A      ;Restore data low byte
                SWAP A      ;Shift low byte to high byte
                ANL  A,#0F0H
                MOV  PORT_LCD,A ;Low byte & RS=0 Write
                LCALL EN_LCD
                MOV  R2,#03H   ;Busy instruction delay

INS_DLY:        MOV  R3,#250
                DJNZ R3,$
                DJNZ R2,INS_DLY
                RET

```

```

;-----
;Enable pin E of LCD
;-----

```

```

EN_LCD:         PUSH  B
                MOV  B,#50    ;Busy delay LCD
                DJNZ B,$
                POP  B
                SETB E_LCD    ;Enable LCD (pin E=Px.2=1)

```

```

NOP
NOP
CLR  E_LCD      ;Disable LCD (pin E=Px.2=0)
RET

```

```

;-----
;Write ASCII to LCD

```

```

;Input: ACC (ASCII)

```

```

WR_LCD:      PUSH  A      ;Save data low byte
             ANL   A,#0F0H
             MOV   PORT_LCD,A ;High byte & RS=1 Write
             SETB  RS_LCD   ;Set RS for write data select
             LCALL EN_LCD
             POP   A      ;Restore data low byte
             SWAP  A      ;Shift low byte to high byte
             ANL   A,#0F0H
             MOV   PORT_LCD,A ;Low byte & RS=1 Write
             SETB  RS_LCD   ;Set RS for write data select
             LCALL EN_LCD
             RET

```

```

;-----
;Goto position of LCD

```

```

;Input : ACC (address of LCD)

```

```

;-----
GOTO_LCD:   SETB  0E7H
             LCALL WR_INS
             RET

```

```
;------;
```

```
;Print data to LCD display
```

```
;------;
```

```
PRINT_LCD: POP DPH
```

```
POP DPL
```

```
PRINT1: CLR A
```

```
MOVC A,@A+DPTR
```

```
CJNE A,#00H,PRINT2
```

```
LJMP PRINT3
```

```
PRINT2: LCALL WR_LCD
```

```
INC DPTR
```

```
LJMP PRINT1
```

```
PRINT3: PUSH DPL
```

```
PUSH DPH
```

```
RET
```

```
;------;
```

```
;Delay time
```

```
;------;
```

```
DELAY: MOV R2,#10
```

```
DLY1: MOV R3,#0FFH
```

```
DLY2: MOV R4,#0FFH
```

```
DJNZ R4,$
```

```
DJNZ R3,DLY2
```

```
DJNZ R2,DLY1
```

```
RET
```

```
end
```


ประวัติผู้จัดทำโครงการ



ชื่อ นายกิตติพงษ์ ยศอาลัย
 ภูมิลำเนา 42 หมู่ 8 ต.เปือ อ.เขียงกลาง จ.น่าน 55160
 ประวัติการศึกษา
 - จบระดับมัธยมจาก โรงเรียนเขียงกลาง “ประชาพัฒนา”
 - ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email : yosarlai@hotmail.com



ชื่อ นายอุกฤษฏ์ ชัยยา
 ภูมิลำเนา 104 ต.แม่ต้า อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 ประวัติการศึกษา
 - จบระดับมัธยมจาก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 - ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email : ukrit_cha@hotmail.com



ชื่อ นายธนวัฒน์ แก้วกัน
 ภูมิลำเนา 126 หมู่ 16 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 62750
 ประวัติการศึกษา
 - จบระดับมัธยมจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
 - ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email : Friday_334@hotmail.com